

上海华岭集成电路技术股份 有限公司股份报价转让说明书



主办券商



上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一二年九月四日

目 录

释 义	1
第一章 声明	7
第二章 风险及重大事项提示	8
一、政策风险	8
二、新技术更新风险	8
三、市场波动风险	8
四、核心技术人员流失风险	8
五、知识产权风险	9
六、关联交易风险	9
七、税收政策变化风险	9
八、大股东不当控制风险	9
第三章 批准试点和推荐备案情况	11
一、上海市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况	11
二、主办券商推荐及协会备案情况	11
第四章 股份挂牌情况	12
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	12
二、股份报价转让情况	12
第五章 公司基本情况	15
一、基本情况	15
二、历史沿革	15
三、主要股东情况	34
四、员工情况	37
五、股权结构表	39
六、组织结构图	41
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	42
一、基本情况	42
二、与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议的情况	45
三、为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施	45
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	45
第七章 公司业务和技术情况介绍	47
一、业务情况	47
二、主要产品的技术含量、可替代性	49
三、所处行业基本情况	51
四、公司面临的主要竞争情况	67

五、知识产权和非专利技术	70
六、核心技术情况	77
七、研发情况	78
八、供应商及前五名客户情况	80
第八章 公司业务发展目标及其风险因素	84
一、未来两年发展计划	84
二、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素	87
第九章 公司治理	92
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	92
二、公司重要事项决策和执行情况	93
三、同业竞争情况	93
四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况	93
五、公司管理层的诚信情况	93
第十章 公司财务会计信息	94
一、报告期间审计意见及主要财务报表	94
二、报告期内主要财务指标	106
三、报告期内利润形成的有关情况	106
四、报告期内的主要资产情况	109
五、报告期内的重大债务情况	117
六、报告期内各期末股东权益情况	121
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	122
八、需提醒投资者关注财务报表附注的期后事项、或有事项及其他重要事项	125
九、股利分配政策和报告期内的分配情况	125
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	125
十一、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析	126
第十一章 备查文件	128

释 义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司
有限公司	指	上海华岭集成电路技术有限责任公司
本说明书、本股份报价转让说明书	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司股份报价转让说明书
股东大会	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会
股东会	指	上海华岭集成电路技术有限责任公司股东会
董事会	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司或上海华岭集成电路技术有限责任公司董事会
监事会	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司或上海华岭集成电路技术有限责任公司监事会
公司章程	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司或上海华岭集成电路技术有限责任公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
复旦微电子	指	上海复旦微电子集团股份有限公司或上海复旦微电子集团股份有限公司
复控华龙	指	上海复控华龙微系统技术有限公司

IC/集成电路	指	在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统。
Wafer/晶圆	指	将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片，即是晶圆，或硅晶圆。
Foundry 模式	指	半导体产业存在的两种商业模式之一，亦称为垂直分工模式，20 世纪 90 年代初兴起的一种新 IC 产业模式，该模式由知识产权（IP）供应商、无生产线设计公司（Fabless）、代工厂商（Foundry）以及封装企业（Package）以及测试企业（Testing）等组成。
IDM 模式	指	IDM 是英文 Integrated Device Manufacture 的缩写，即垂直集成模式，IDM 模式的特点是，企业经营范围涵盖了芯片设计、生产制造、封装测试各环节，甚至延伸至下游终端。美国和日本半导体产业主要采用这一模式，IDM 企业规模大、投入高，典型的 IDM 企业有：英特尔、三星、德州仪器、东芝和意法半导体。
SoC	指	SoC 是英文 System-on-Chip 的缩写，即系统级芯片，指的是在单个硅片上集成子系统或系统，包括处理器、高密度逻辑电路、模拟和混合信号电路、存储器等。

RF	指	射频技术 (Radio Frequency), 是指利用无线频率变换对承载信息进行空间传播、并完成承载信息收发或读写的技术
CPU	指	CPU(Central Processing Unit)中央处理器, 计算机的心脏, 包括运算部件和控制部件, 是完成各种运算和控制的核​​心, 也是决定计算机性能的最重要的部件。
DSP	指	DSP 芯片, 也称数字信号处理器, 是一种具有特殊结构的微处理器, 具有专门的硬件乘法器, 广泛采用流水线操作, 提供特殊的 DSP 指令, 可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。
MCU	指	MCU(Micro Controller Unit)中文名称为多点控制单元, 又称单片微型计算机 (Single Chip Microcomputer), 是指随着大规模集成电路的出现及其发展, 将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上, 形成芯片级的计算机, 为不同的应用场合做不同组合控制。
DRAM	指	(Dynamic Random Access Memory), 即动态随机存储器最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据, DRAM 使用电容存储, 所以 必须隔一段时间刷新 (refresh) 一次, 如果存储单元没有被刷新, 存储的信息就会丢失。

SRAM	指	SRAM 是英文 Static RAM 的缩写，它是一种具有静止存取功能的内存，不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。
SOI	指	SOI 是 Silicon-On-Insulator 的缩写，是一种新型的硅基集成电路材料，这类材料是为了适应航空航天电子、导弹等武器系统的控制和卫星电子系统的需求而发展起来的。
FLASH	指	闪存，也称“Flash Memory”，是于内存器件的一种，在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据，其存储特性相当于硬盘，这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
PROM	指	PROM (Programmable Read-Only Memory) 一可编程只读存储器，也叫 One-Time Programmable (OTP) ROM “一次可编程只读存储器”，是一种可以用程序操作的只读内存。最主要特征是只允许数据写入一次，如果数据输入错误只能报废。
EPROM	指	EPROM (Erasable Programmable ROM, 可擦除可编程 ROM) 芯片可重复擦除和写入，解决了 PROM 芯片只能写入一次的弊端
EEPROM	指	电可擦写可编程只读存储器 (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), 一种掉电后数据不丢失的存储芯片。

		EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，重新编程。
FPGA	指	FPGA (Field - Programmable Gate Array), 即现场可编程门阵列, 它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路 (ASIC) 领域中的一种半定制电路而出现的, 既解决了定制电路的不足, 又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
LVDS	指	LVDS 即低压差分信号传输, 是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术, 是由美国国家半导体公司提出的一种信号传输模式, 它是一种标准, 它在提供高数据传输率的同时会有很低的功耗。
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
内核小组	指	上海证券有限责任公司报价转让业务推荐挂牌项目内核小组
上海上会	指	上海上会会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所

浦东工商局	指	上海市工商行政管理局浦东新区分局
挂牌	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司股份在证券公司代办股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
报告期	指	2010 年度、2011 年度及 2012 年 1 至 6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。

第一章 声明

公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、政策风险

近年来，国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策，若未来国家政策发生变化，降低对集成电路行业的扶持力度，则可能对公司的主营业务产生重大影响；同时，政府可能减少项目投入，若公司无法获得政府资金方面的支持，则将对公司发展速度产生一定影响。

二、新技术更新风险

公司是一家集成电路测试企业，测试技术研发能力是公司最重要的核心竞争力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋加快，公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市场需求的变化，未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面临的重要风险。

三、市场波动风险

公司属于集成电路行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供测试服务，是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将势必对集成电路测试行业带来重大影响。

四、核心技术人员流失风险

集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的

重要因素。随着集成电路行业的发展，集成电路企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。

五、知识产权风险

公司在集成电路测试技术和程序研发中，申请了大量软件著作权、技术专利等知识产权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要的作用，因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。

六、关联交易风险

2010年、2011年以及2012年1-6月，公司对控股股东复旦微电子的销售收入占公司销售收入的比例分别为44.83%、43.95%、46.54%，公司主要业务存在关联方（控股股东）占比较高的经营风险。如果控股股东的生产经营情况发生不利变化，或其竞争能力下降，将有可能减少对公司的测试业务，从而对公司的销售收入带来不利影响。

七、税收政策变化风险

公司被认定为国家级高新技术企业，按15%的优惠税率申报缴纳企业所得税，发生的研发费用可按实际发生额的150%加计抵扣当年的企业应纳税所得额。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

八、大股东不当控制风险

公司的法人股东复旦微电子拥有公司64.90%的股份，若公司控股股东及相关人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行

不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

第三章 批准试点和推荐备案情况

一、上海市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和公司 2012 年度股东大会的决议，公司向上海市金融服务办公室递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2012 年 9 月 3 日，上海市金融服务办公室以沪金融办【2012】237 号文，下发了《上海市金融服务区办公室关于拟同意上海华岭集成电路技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

二、主办券商推荐及协会备案情况

上海证券作为公司的主办券商，对公司进行了尽职调查和内部审核。经上海证券内核小组审核、表决通过，同意推荐公司挂牌，并出具了《上海证券有限责任公司关于推荐上海华岭集成电路技术股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的报告》。2012 年 8 月 27 日，上海证券向证券业协会报送了推荐公司挂牌的备案文件。

2012 年 9 月 4 日，证券业协会出具了《关于推荐上海华岭集成电路技术股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2012】595 号），对上海证券报送的推荐公司挂牌报价文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称： 华岭股份

股份代码： 430139

挂牌日期： 2012 年 9 月 7 日

二、股份报价转让情况

（一）公司股份总数及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

1、股份总数：

公司股份总数为 3100 万股。

2、公司分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

根据《公司章程》第十四条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”公司董事、监事及高级管理人员首批解除限售的股份为其所持公司股份的 25%。

根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定，“非上市公司控股股东及实际控制

人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让, 每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”公司控股股东复旦微电子所持股份依照前述规定办理相关手续。

第十六条规定, “挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的, 该股份的管理适用前条的规定。”

第十七条规定, “挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的, 货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让, 非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

(二) 挂牌时, 可报价转让股份的情况

序号	股东	持股数 (股)	挂牌时, 可报价转让股份数量 (股)	受限原因
1	复旦微电子	20,117,527	6,705,842	控股股东
2	卢尔健	2,371,499	592,874	董事
3	张志勇	2,056,207	514,051	董事、高管
4	叶守银	1,457,081	364,270	高管
5	刘远华	1,246,588	311,647	高管
6	汪瑞祺	805,603	805,603	-
7	牛勇	457,262	457,262	-
8	祁建华	387,058	387,058	-
9	施瑾	200,000	50,000	董事
10	马庆容	170,000	170,000	-
11	刘后权	150,000	150,000	-
12	王元彪	110,000	110,000	-
13	汤雪飞	100,000	25,000	高管
14	俞军	100,000	25,000	董事
15	王苏	100,000	25,000	董事
16	李清	100,000	100,000	-
17	王锦	97,058	24,264	监事

18	李桂华	90,000	90,000	-
19	郑昭蓉	67,058	67,058	-
20	刘军	62,353	15,588	高管
21	方静	50,000	12,500	监事
22	程君侠	40,000	40,000	-
23	马福斌	40,000	40,000	-
24	李蔚	40,000	40,000	-
25	纪兰花	40,000	40,000	-
26	刁林山	40,000	40,000	-
27	戴忠东	40,000	40,000	-
28	沈磊	40,000	40,000	-
29	梁小云	40,000	40,000	-
30	梅利军	40,000	40,000	-
31	丁琪琪	40,000	40,000	-
32	张艳丰	40,000	40,000	-
33	刘以非	40,000	40,000	-
34	方华	40,000	40,000	-
35	沈晓芳	22,353	22,353	-
36	王亮	22,353	22,353	-
37	曹治中	20,000	20,000	-
38	凌俭波	20,000	20,000	-
39	叶建明	20,000	20,000	-
40	徐惠	20,000	20,000	-
41	黄轶强	20,000	20,000	-
42	王静	20,000	20,000	-
43	张映	20,000	20,000	-
合计		31,000,000	11,707,723	

上述股东股份无质押或冻结等限制情况。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：上海华岭集成电路技术股份有限公司

法定代表人：施瑾

有限公司成立日期：2001年4月28日

股份公司成立日期：2010年6月18日

注册资本：3100万元

注册住所：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼1楼

联系地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼2楼

电话：+86-21-50278216

传真：+86-21-50278219

电子邮箱：hyqhl@sinoicetest.com.cn

互联网网址：<http://www.sinoicetest.com>

证券事务代表：黄轶强

所属行业：集成电路测试行业

经营范围：集成电路技术开发、应用、技术咨询，集成电路芯片及集成电路产品测试，探针卡、测试板设计，软件产品设计，国内贸易（除专项），从事货物与技术的进出口业务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

主营业务：集成电路测试和相关技术的开发、应用、生产测试。

高新技术企业资格：2011年8月17日，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为“GF201131000034”，有效期为三年。

二、历史沿革

（一）有限公司设立

公司前身上海华岭集成电路技术有限责任公司成立于2001年4月28日，

营业执照注册号为 3101151016126，由法人上海复旦微电子股份有限公司（该公司于 2010 年 12 月 2 日更名为“上海复旦微电子集团股份有限公司”）与自然人卢尔健、张志勇、叶守银、武乾文、刘远华、张祖民和王锦等七名自然人共同出资设立。公司住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 A-485 座，法定代表人卢尔健，注册资本人民币 1000 万元，经营范围为集成电路测试软件的开发，集成电路芯片及集成电路产品测试，探针卡制造，集成电路技术开发、技术咨询，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营），经营期限为 30 年。股东均以现金方式出资，具体如下表：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）
复旦微电子	900.00	900.00	90.00
卢尔健	75.00	25.00	2.50
张志勇	10.00	10.00	1.00
叶守银	5.00	5.00	0.50
武乾文	4.00	4.00	0.40
刘远华	3.00	3.00	0.30
张祖明	2.00	2.00	0.20
王锦	1.00	1.00	0.10
总计	1000.00	950.00	95.00

上海东华会计师事务所有限公司 2001 年 4 月 17 日出具了东会验[2001]字（2001）1037 号验资报告，该验资报告载明“有限公司注册资本为 1000 万元”，“截至 2001 年 4 月 17 日，上海华岭集成电路技术有限责任公司已于 2001 年 4 月 17 日缴存我所验资专户人民币 950 万元。其中上海复旦微电子股份有限公司投入实收资本 900 万元，占注册资金 90%；自然人卢尔健投入实收资本 25 万元，占注册资金 2.5%；张志勇投入实收资本 10 万元，占注册资金 1%；叶守银投入实收资本 5 万元，占注册资金 0.5%；武乾文投入实收资本 4 万元，占注册资金 0.4%；刘远华投入实收资本 3 万元，占注册资金 0.3%；张祖明投入实收资本 2 万元，占注册资金 0.2%；王锦投入实收资本 1 万元，占注册资金 0.1%。”

根据该验资报告，卢尔健认缴注册资本 75 万，公司设立时投入实收资本 25 万元，尚有 50 万元出资未到位。有限公司全体股东于 2001 年 4 月 20 日向浦东工

商分局承诺其余 5%认缴的出资在 3 年内全部到位。华岭有限股东于 2004 年 4 月认缴了未到位的 50 万元出资，具体情况详见后述“第二次股权转让”。

（二）有限公司时期历次变更

1、第一次股权转让、第一次注册地址变更和第一次经营范围变更

2002 年 1 月 28 日，有限公司股东武乾文、张祖明分别与汪瑞琪、牛勇、郑昭蓉、祁建华签订《股权转让协议》，转让其持有的公司股权，其中：武乾文向汪瑞琪转让 2 万元出资、向牛勇转让 2 万元出资；张祖明向郑昭蓉转让 1 万元出资、向祁建华转让 1 万元出资，转让价格为每一出资额为人民币一元。经有限公司第一届第二次股东会决议，其他股东放弃优先受让权。股权转让后公司股东出资情况明细如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）
复旦微电子	900.00	900.00	90.00
卢尔健	75.00	25.00	2.50
张志勇	10.00	10.00	1.00
叶守银	5.00	5.00	0.50
刘远华	3.00	3.00	0.30
汪瑞琪	2.00	2.00	0.20
牛勇	2.00	2.00	0.20
王锦	1.00	1.00	0.10
郑昭蓉	1.00	1.00	0.10
祁建华	1.00	1.00	0.10
总计	1000.00	950.00	95.00

本次会议还决议变更有限公司注册地址，新地址为“郭守敬路 498 号 1112, 1114, 1117, 1119 室”，以及公司经营范围增加了“进出口”业务。

2002 年 6 月 21 日，浦东工商局核准了上述变更事项，并换发了营业执照。

2、第二次股权转让

2004 年 4 月 8 日，有限公司股东卢尔健分别与张志勇等 11 名自然人签署了股权转让协议，将其持有的 39 万元出资权转让给这 11 名自然人，其中：向张志勇转让 11 万元出资，向叶守银转让 8 万元出资，向刘远华转让 7 万元出资，分

别向王锦、汪瑞祺、牛勇、郑昭蓉、祁建华等五人转让 2 万元出资，分别向刘军、沈晓芳、王亮等三人转让 1 万元出资。经有限公司第二届第二次股东会决议，其他股东放弃优先受让权。

由于有限公司成立时，卢尔健 50 万元出资尚未到位，故本次转让后，受让卢尔健股权的 11 名自然人认缴了 39 万元注册资本，卢尔健认缴了 11 万元注册资本，二者共计 50 万元，至此有限公司 1000 万元注册资本全部到位。2004 年 4 月 28 日，上海新中创会计师事务所有限公司对上述认缴注册资本行为进行了验证，并出具了新中创会师报字（2004）0618 号《验资报告》。

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
复旦微电子	900.00	90.00
卢尔健	36.00	3.60
张志勇	21.00	2.10
叶守银	13.00	1.30
刘远华	10.00	1.00
汪瑞祺	4.00	0.40
牛勇	4.00	0.40
王锦	3.00	0.30
郑昭蓉	3.00	0.30
祁建华	3.00	0.30
刘军	1.00	0.10
沈晓芳	1.00	0.10
王亮	1.00	0.10
合计	1000.00	100.00

2004 年 5 月 10 日，浦东工商局核准了上述变更事项，并换发了营业执照。

4、第一次注册资本增加

2005 年 7 月 10 日，有限公司召开第二届第三次股东大会，股东一致同意，根据上海市浦东新区相关人力资本作价入股的政策，由自然人股东卢尔健、张志勇、叶守银、刘远华、汪瑞祺和牛勇等 6 人以人力资本入股，将注册资本由原来 1000 万元，增加至 1300 万元。该 6 名股东所占人力资本出资金额明细如下：

增资股东姓名	人力资本增资金额（万元）
卢尔健	75
张志勇	75
叶守银	54
刘远华	47
汪瑞祺	33
牛勇	16
合计	300

上述增资行为，2005年9月15日由上海新中创会计师事务所有限公司出具新中创会师报字（2005）0774号《验资报告》进行了验证。

经过本次增资，各股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
复旦微电子	900	69.20
卢尔健	111	8.50
张志勇	96	7.40
叶守银	67	5.20
刘远华	57	4.40
汪瑞祺	37	2.90
牛勇	20	1.50
王锦	3	0.23
郑昭蓉	3	0.23
祁建华	3	0.23
刘军	1	0.07
沈晓芳	1	0.07
王亮	1	0.07
合计	1300	100.00

2005年10月9日，浦东工商局核准了上述变更事项，并换发了营业执照。

本次增资符合当时《浦东新区人力资本出资试行办法》的规定，鉴于该行为不符合现行《公司法》的有关规定，上述增资的6名股东已于2010年4月22

日使用等额现金 300 万元置换了该等人力资本出资，对本次出资瑕疵进行了规范，具体情况详见后述“**股东现金置换历史人力资本出资**”。

5、第二次注册地址变更

2006 年 3 月 17 日，有限公司变更公司住所，变更后有限公司住所为上海浦东郭守敬路 498 号浦东软件园 1 幢 1106-1114；1113-1119 号。

6、第三次注册地址变更

2007 年 3 月 12 日，有限公司变更公司住所，变更后有限公司住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼。

7、第一次法定代表人变更

2007 年 11 月 12 日，有限公司变更公司董事长暨法定代表人，变更后董事长/法定代表人为施瑾。

8、第二次注册资本增加

2009 年 3 月 6 日，有限公司召开 2009 年第一次股东会，股东一致同意用历年公司未分配利润转增公司注册资本方案，注册资本由 1300 万元增加至 2850 万元。各股东按如下分配金额用于增资：

股东	增资金额（万元）	增资后出资额（万元）
复旦微电子	1111.7527	2011.7527
卢尔健	123.1499	234.1499
张志勇	104.6207	200.6207
叶守银	72.7081	139.7081
刘远华	61.6588	118.6588
汪瑞祺	39.5603	76.5603
牛勇	21.7262	41.7262
王锦	3.7058	6.7058
郑昭蓉	3.7058	6.7058
祁建华	3.7058	6.7058
刘军	1.2353	2.2353
沈晓芳	1.2353	2.2353
王亮	1.2353	2.2353

合计	1550.00	2850.00
----	---------	---------

上述未分配利润转增公司注册资本经上海君宜会计师事务所有限公司 2009 年 3 月 20 日出具君宜会师报字（2009）第 265 号《验资报告》进行了验证。

上述未分配利润转增公司注册资本比例并未按各股东原出资比例进行分配，而是股东按照公司法第三十五条规定，一致协商后针对本次分配做出的重新约定，合法有效。

至此，公司股东出资情况如下：

股东	出资总额（万元）	出资比例（%）
复旦微电子	2011.7527	70.588
卢尔健	234.1499	8.216
张志勇	200.6207	7.039
叶守银	139.7081	4.902
刘远华	118.6588	4.163
汪瑞祺	76.5603	2.686
牛勇	41.7262	1.464
王锦	6.7058	0.235
郑昭蓉	6.7058	0.235
祁建华	6.7058	0.235
刘军	2.2353	0.079
沈晓芳	2.2353	0.079
王亮	2.2353	0.079
合计	2850.00	100%

2009 年 3 月 27 日，浦东工商局核准了上述变更事项，并换发了营业执照。

9、第二次经营范围变更

2009 年 4 月 2 日，有限公司的经营经营范围变更，由“集成电路测试软件开发，集成电路芯片及集成电路产品测试，探针卡制造；集成电路开发和技术咨询等服务以及其它高新技术产品的销售和投资业务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。”变更为“集

成电路技术开发、应用，技术咨询，集成电路芯片及集成电路产品测试，探针卡、测试板设计、制造，软件产品设计，销售自产产品，从事货物与技术的进出口业务[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。”

10、第三次注册资本增加

2009年12月3日，有限公司召开2009年第二次股东会，股东一致同意公司注册资本由2850万元增加至3100万元。下述39名自然人以人民币1.13元认购一元出资额的方式认缴本次增资金额，共计282.5万元。本次增资价格根据有限公司2009年10月31日经审计的每股净资产确定。具体缴纳出资人员及出资金额如下表：

股东	缴纳增资金额（万元）	备注
祁建华	36.16	36.16万元中有32万元计入注册资本， 剩余4.16万元计入资本公积
施瑾	22.6	22.6万元中有20万元计入注册资本， 剩余2.6万元计入资本公积
马庆容	19.21	19.21万元中有17万元计入注册资本， 剩余2.21万元计入资本公积
刘后权	16.95	16.95万元中有15万元计入注册资本， 剩余1.95万元计入资本公积
王元彪	12.43	12.43万元中有11万元计入注册资本， 剩余1.43万元计入资本公积
李桂华	10.17	10.17万元中有9万元计入注册资本， 剩余1.17万元计入资本公积
汤雪飞	11.30	11.3万元中有10万元计入注册资本， 剩余1.3万元计入资本公积
俞军	11.30	11.3万元中有10万元计入注册资本， 剩余1.3万元计入资本公积
王苏	11.30	11.3万元中有10万元计入注册资本， 剩余1.3万元计入资本公积
李清	11.30	11.3万元中有10万元计入注册资本，

		剩余 1.3 万元计入资本公积
叶守银	6.78	6.78 万元中有 6 万元计入注册资本, 剩余 0.78 万元计入资本公积
刘远华	6.78	6.78 万元中有 6 万元计入注册资本, 剩余 0.78 万元计入资本公积
张志勇	5.65	5.65 万元中有 5 万元计入注册资本, 剩余 0.65 万元计入资本公积
方静	5.65	5.65 万元中有 5 万元计入注册资本, 剩余 0.65 万元计入资本公积
汪瑞祺	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
牛勇	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
刘军	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
程君侠	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
马福斌	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
李蔚	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
纪兰花	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
刁林山	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
戴忠东	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
沈磊	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
梁小云	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
梅利军	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
丁琪琪	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
张艳丰	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
刘以非	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积
方华	4.52	4.52 万元中有 4 万元计入注册资本, 剩余 0.52 万元计入资本公积

王锦	3.39	3.39 万元中有 3 万元计入注册资本, 剩余 0.39 万元计入资本公积
卢尔健	3.39	3.39 万元中有 3 万元计入注册资本, 剩余 0.39 万元计入资本公积
曹治中	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
凌俭波	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
叶建明	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
徐惠	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
赵达君	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
沈懿桦	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
张映	2.26	2.26 万元中有 2 万元计入注册资本, 剩余 0.26 万元计入资本公积
合计	282.50	

上述增资行为经上海君宜会计师事务所有限公司 2009 年 12 月 30 日出具君宜会师报字(2009)第 803 号《验资报告》进行了验证。

经过本次增资, 有限公司股东出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60
7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55
11	刘后权	15.00	0.48

12	王元彪	11.00	0.36
13	汤雪飞	10.00	0.32
14	俞军	10.00	0.32
15	王苏	10.00	0.32
16	李清	10.00	0.32
17	王锦	9.7058	0.31
18	李桂华	9.00	0.29
19	郑昭蓉	6.7058	0.22
20	刘军	6.2353	0.20
21	方静	5.00	0.16
22	程君侠	4.00	0.13
23	马福斌	4.00	0.13
24	李蔚	4.00	0.13
25	纪兰花	4.00	0.13
26	刁林山	4.00	0.13
27	戴忠东	4.00	0.13
28	沈磊	4.00	0.13
29	梁小云	4.00	0.13
30	梅利军	4.00	0.13
31	丁琪琪	4.00	0.13
32	张艳丰	4.00	0.13
33	刘以非	4.00	0.13
34	方华	4.00	0.13
35	沈晓芳	2.2353	0.07
36	王亮	2.2353	0.07
37	曹治中	2.00	0.07
38	凌俭波	2.00	0.07
39	叶建明	2.00	0.07

40	徐惠	2.00	0.07
41	赵达君	2.00	0.07
42	沈懿桦	2.00	0.07
43	张映	2.00	0.07
合计		3100.00	100.000

2010年1月15日，浦东工商局核准了上述变更事项，并换发了营业执照。

11、股东现金置换历史人力资本出资

2010年4月21日公司召开股东会一致同意自然人股东卢尔健、张志勇、叶守银、刘远华、汪瑞祺和牛勇等6人以等额现金替换2005年7月的人力资本出资。具体替换明细如下：

股东姓名	原人力资本出资折价金额（万元）	替换现金金额（万元）
卢尔健	75.00	75.00
张志勇	75.00	75.00
叶守银	54.00	54.00
刘远华	47.00	47.00
汪瑞祺	33.00	33.00
牛勇	16.00	16.00
总计	300.00	300.00

上海君宜会计师事务所有限公司于2010年4月25日出具编号为君宜会师报字（2010）第545号《验资报告》对上述出资行为进行了确认。至此，公司股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60

7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55
11	刘后权	15.00	0.48
12	王元彪	11.00	0.36
13	汤雪飞	10.00	0.32
14	俞军	10.00	0.32
15	王苏	10.00	0.32
16	李清	10.00	0.32
17	王锦	9.7058	0.31
18	李桂华	9.00	0.29
19	郑昭蓉	6.7058	0.22
20	刘军	6.2353	0.20
21	方静	5.00	0.16
22	程君侠	4.00	0.13
23	马福斌	4.00	0.13
24	李蔚	4.00	0.13
25	纪兰花	4.00	0.13
26	刁林山	4.00	0.13
27	戴忠东	4.00	0.13
28	沈磊	4.00	0.13
29	梁小云	4.00	0.13
30	梅利军	4.00	0.13
31	丁琪琪	4.00	0.13
32	张艳丰	4.00	0.13
33	刘以非	4.00	0.13
34	方华	4.00	0.13

35	沈晓芳	2.2353	0.07
36	王亮	2.2353	0.07
37	曹治中	2.00	0.07
38	凌俭波	2.00	0.07
39	叶建明	2.00	0.07
40	徐惠	2.00	0.07
41	赵达君	2.00	0.07
42	沈懿桦	2.00	0.07
43	张映	2.00	0.07
合计		3100.00	100.000

本次变更并未改变有限公司注册资本总额,也未导致有限公司股东及其持股比例的变化,仅将历史遗留的出资方式不符合现行《公司法》的问题进行了规范。2010年4月27日浦东工商局核准了上述变更事项,并换发了营业执照。

(三) 有限公司整体变更为股份公司

有限公司为筹备整体变更为股份公司聘请了上海上会和上海银信汇业资产评估公司分别进行资产审计和评估工作。

根据上海上会出具的上会师报字(2010)第1595号《审计报告》,截至2010年4月30日有限公司的净资产为人民币44093536.01元,以及上海银信汇业资产评估公司出具的沪银信汇业评报字【2010】第B072号《评估报告》,截至2010年4月30日有限公司的净资产评估值为47,998,213.98元。有限公司股东会于2010年5月31日通过决议,同意根据上海上会出具的上会师报字(2010)第1595号《审计报告》,以2010年4月30日为基准日经审计的公司净资产折股,将有限公司整体变更为股份有限公司。

2010年6月1日,有限公司43名股东作为发起人签署《上海华岭集成电路技术股份有限公司发起人协议书》同意设立上海华岭集成电路技术股份有限公司。上海上会于2010年6月2日出具上会师报字(2010)第1611号《验资报告》,确认公司注册资本为3100万元,有限公司依据2010年4月30日为基准日审计确认的净资产按1:0.7030509的比例折合股本3100万股,实收资本3100万元,剩余净资产全部计入公司资本公积金。

2010年6月2日公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意有限公司股东作为公司发起人，通过有限公司整体变更，发起设立新的股份有限公司。股份公司总股本3100万股，每股面值一元，注册资本3100万元。发起人持股比例与其投资有限公司的出资比例相同。选举了股份公司第一届董事会及监事会，并授权新选举的公司董事会办理相关登记事宜。

股份公司股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60
7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55
11	刘后权	15.00	0.48
12	王元彪	11.00	0.36
13	汤雪飞	10.00	0.32
14	俞军	10.00	0.32
15	王苏	10.00	0.32
16	李清	10.00	0.32
17	王锦	9.7058	0.31
18	李桂华	9.00	0.29
19	郑昭蓉	6.7058	0.22
20	刘军	6.2353	0.20
21	方静	5.00	0.16

22	程君侠	4.00	0.13
23	马福斌	4.00	0.13
24	李蔚	4.00	0.13
25	纪兰花	4.00	0.13
26	刁林山	4.00	0.13
27	戴忠东	4.00	0.13
28	沈磊	4.00	0.13
29	梁小云	4.00	0.13
30	梅利军	4.00	0.13
31	丁琪琪	4.00	0.13
32	张艳丰	4.00	0.13
33	刘以非	4.00	0.13
34	方华	4.00	0.13
35	沈晓芳	2.2353	0.07
36	王亮	2.2353	0.07
37	曹治中	2.00	0.07
38	凌俭波	2.00	0.07
39	叶建明	2.00	0.07
40	徐惠	2.00	0.07
41	赵达君	2.00	0.07
42	沈懿桦	2.00	0.07
43	张映	2.00	0.07
合计		3100.00	100.000

公司于2010年6月18日获得上海市工商行政管理局颁发的工商营业执照。注册号为310115000612853，公司经营期限为永久。

1、股份公司第一次股份转让

2011年6月21日股东赵达君与自然人黄轶强签署了《股权转让合同》，合同约定赵达君向黄轶强转让其所持的上海华岭集成电路技术股份有限公司的全部股份2万股，每股对价1.568元。经过本次转让，公司股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60
7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55
11	刘后权	15.00	0.48
12	王元彪	11.00	0.36
13	汤雪飞	10.00	0.32
14	俞军	10.00	0.32
15	王苏	10.00	0.32
16	李清	10.00	0.32
17	王锦	9.7058	0.31
18	李桂华	9.00	0.29
19	郑昭蓉	6.7058	0.22
20	刘军	6.2353	0.20
21	方静	5.00	0.16
22	程君侠	4.00	0.13
23	马福斌	4.00	0.13
24	李蔚	4.00	0.13
25	纪兰花	4.00	0.13
26	刁林山	4.00	0.13
27	戴忠东	4.00	0.13

28	沈磊	4.00	0.13
29	梁小云	4.00	0.13
30	梅利军	4.00	0.13
31	丁琪琪	4.00	0.13
32	张艳丰	4.00	0.13
33	刘以非	4.00	0.13
34	方华	4.00	0.13
35	沈晓芳	2.2353	0.07
36	王亮	2.2353	0.07
37	曹治中	2.00	0.07
38	凌俭波	2.00	0.07
39	叶建明	2.00	0.07
40	徐惠	2.00	0.07
41	黄轶强	2.00	0.07
42	沈懿桦	2.00	0.07
43	张映	2.00	0.07
合计		3100.00	100.00

2、股份公司第二次股份转让

2011年7月25日，股东沈懿桦与自然人王静也签署了《股权转让合同》，合同约定沈懿桦向王静转让其所持的上海华岭集成电路技术股份有限公司的全部股份2万股，每股对价1.568元。经过上述转让，公司股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60

7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55
11	刘后权	15.00	0.48
12	王元彪	11.00	0.36
13	汤雪飞	10.00	0.32
14	俞军	10.00	0.32
15	王苏	10.00	0.32
16	李清	10.00	0.32
17	王锦	9.7058	0.31
18	李桂华	9.00	0.29
19	郑昭蓉	6.7058	0.22
20	刘军	6.2353	0.20
21	方静	5.00	0.16
22	程君侠	4.00	0.13
23	马福斌	4.00	0.13
24	李蔚	4.00	0.13
25	纪兰花	4.00	0.13
26	刁林山	4.00	0.13
27	戴忠东	4.00	0.13
28	沈磊	4.00	0.13
29	梁小云	4.00	0.13
30	梅利军	4.00	0.13
31	丁琪琪	4.00	0.13
32	张艳丰	4.00	0.13
33	刘以非	4.00	0.13
34	方华	4.00	0.13

35	沈晓芳	2.2353	0.07
36	王亮	2.2353	0.07
37	曹治中	2.00	0.07
38	凌俭波	2.00	0.07
39	叶建明	2.00	0.07
40	徐惠	2.00	0.07
41	黄轶强	2.00	0.07
42	王静	2.00	0.07
43	张映	2.00	0.07
合计		3100.00	100.00

三、主要股东情况

(一) 前十名股东及其持股数量

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60
7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

1、公司控股股东复旦微电子设立于1998年7月10日，注册资本为人民币6173.3万元，存续期为不约定期限，注册地址为上海市邯郸路220号，经营范

围为“研究开发、生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务。投资举办符合国家高新技术产业目录的项目”。法定代表人蒋国兴，营业执照号310000400198084。此外该公司于2000年8月在香港创业板上市，交易代码8102。复旦微电子的主要股东及持股情况如下：

股东名称	持股比例（%）	备注
上海复旦微电子集团股份有限公司职工持股会	23.36	
上海复旦科技产业控股有限公司	17.76	该公司由上海商投持有90%的股份，上海商投为上海市政府全资设立的国有企业
上海复旦高技术公司	17.29	该公司为上海复旦大学全资设立的国有企业

综上，公司控股股东为复旦微电子，但无实际控制人。

2、除公司外，复旦微电子控制的其他公司基本情况：

（1）上海复旦微电子（香港）有限公司设立于2002年1月23日，注册资本为港币700万元，存续期为无限期，注册地址为Flat/RM 506 5F EAST OCEAN CENTRE 98 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST KL，经营范围为“电子产品销售及相关技术服务”。营业执照编号783718。复旦微电子持有该公司100%的股权。

（2）深圳市复旦微电子技术有限公司设立于2007年8月16日，注册资本为人民币500万元，存续期为永续经营，注册地址为深圳福田区华强北路4014号长盛大厦1301-1309房，经营范围为“电子产品及系统软件的设计、技术开发、销售及相关技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。法定代表人王苏，营业执照号440301102783894。复旦微电子持有该公司100%的股权。

（3）北京复旦微电子技术有限公司设立于2007年12月25日，注册资本为人民币100万元，存续期为20年，注册地址为北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦B1层D区-37，经营范围为根据国家法律法规自主选择经营项目开展经营活动。法定代表人俞军，营业执照号110108010700686。复旦微电子持有该公司100%的股权。

（4）上海复控华龙微系统技术有限公司设立于2007年10月8日，注册资

本为人民币 3000 万元，存续期为 20 年，注册地址为上海张江高科技园区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 507 室，经营范围为“微电子产品、电子元器件的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资管理、投资咨询（除经纪）”。法定代表人韦然，营业执照号 310115001037869。复旦微电子持有该公司 100% 的股权。

3、复旦微电子投资的其他公司基本情况：

(1) 上海中京电子标签集成技术有限公司设立于 2005 年 11 月 8 日，注册资本为人民币 500 万元，存续期为 20 年，注册地址为上海张江高科技园区郭守敬路 251 号 1 号楼 405 室，经营范围为“电子标签产品、电子识读设备的研发、生产、销售自主研发产品，软件开发、计算机系统集成，并提供相关技术咨询和服务”。法定代表人冀京秋，营业执照号 3101152024573。复旦微电子持有该公司 10% 的股权。

(2) 上海分点科技有限公司设立于 2009 年 8 月 4 日，注册资本为人民币 630 万元，存续期为永久，注册地址为上海杨浦区国泰路 127 弄 2 号楼 201 室，经营范围为“计算机网路科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件（除计算机信息系统系统安全专用产品）、电子产品、通讯器材的开发、销售；广告设计、制作、代理”。法定代表人马福斌，营业执照号 310110000497388。复旦微电子持有该公司 26.4% 的股权。

(3) 浙江京昌电子股份有限公司设立于 2001 年 12 月 19 日，注册资本为人民币 4000 万元，存续期为永久，注册地址为浙江湖州市南浔区双林镇镇西，经营范围为“宽、窄带通讯电子产品、汽车电子产品、功率模块、微波电路、电源电子产品、电子胶带及其他电子产品的设计、生产、表面贴膜加工、电路板图激光光绘”。法定代表人徐淦芳，营业执照号 3300001008350。复旦微电子持有该公司 10% 的股权。

(4) 上海复旦通讯股份有限公司设立于 2002 年 3 月 8 日，注册资本为人民币 6105.3 万元，存续期为永久，注册地址为上海国泰路 127 弄 1 号楼 3 楼，经营范围为“研究开发、生产、销售通讯产品、高科技产品并提供相关服务，卫星地面接收设施安装”。法定代表人丁圣彪，营业执照号 310000000083023。复旦微电子持有该公司 22.4% 的股权。

（三）其他主要股东简历

1、股东：卢尔健，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1938 年 7 月，1956 年毕业于复旦大学，教授，高级工程师。历任上海长丰智能卡有限责任公司董事总裁、上海贝岭股份有限公司董事总裁、中国集成电路行业协会副理事长。2001 年 4 月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司任董事长，2007 年 10 月起辞去董事长留任董事。2010 年 6 月 2 日，经公司股东大会选举为公司董事，任期三年。持有公司股份 237.1499 万股；

2、股东：张志勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320211196205093418，住址：上海市浦东新区长岛路 728 弄 43 号 601 室，生于 1962 年 5 月。1983 年毕业于电子科技大学，研究员。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师、信息产业部电子五十八所研究员，2001 年 4 月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司任董事、总经理。国家科技部、工信部专家库专家，多项国家级重大科研项目负责人，上海市领军人才和优秀学科带头人，江苏省跨世纪学科带头人，国家科技进步二等奖、机械电子工业部科技进步二等奖、江苏省国防科技进步一等奖、浦东新区专家学术奖获得者。2010 年 6 月 2 日，经公司股东大会选举为公司董事，经公司第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理，任期三年。持有公司股份 205.6207 万股。

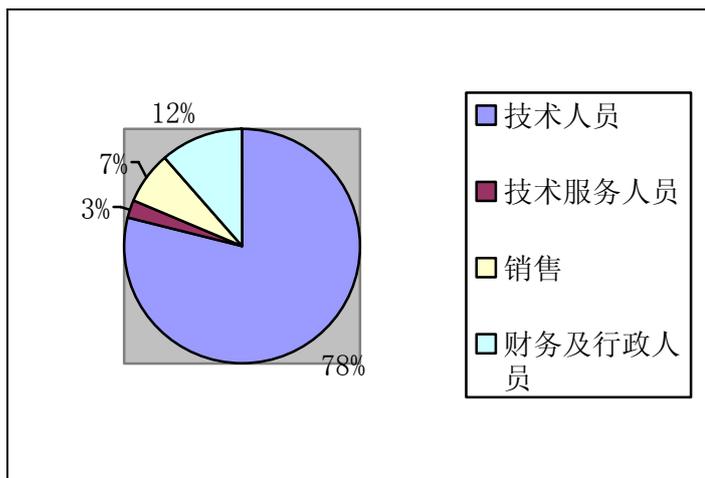
（四）主要股东之间关联关系

姓名	关联方	关联关系
张志勇	刘远华	夫妻
叶守银	王锦	夫妻
牛勇	张映	夫妻
施瑾	复旦微电子	施瑾任复旦微电子副总经理

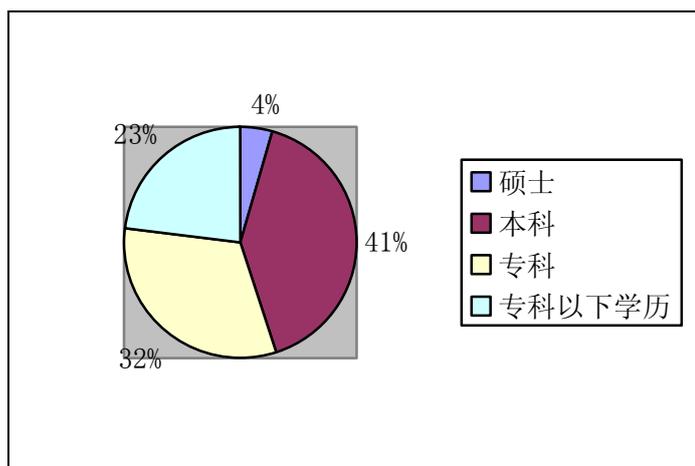
四、员工情况

（一）截至 2012 年 7 月 20 日，公司员工总数为 113 人；

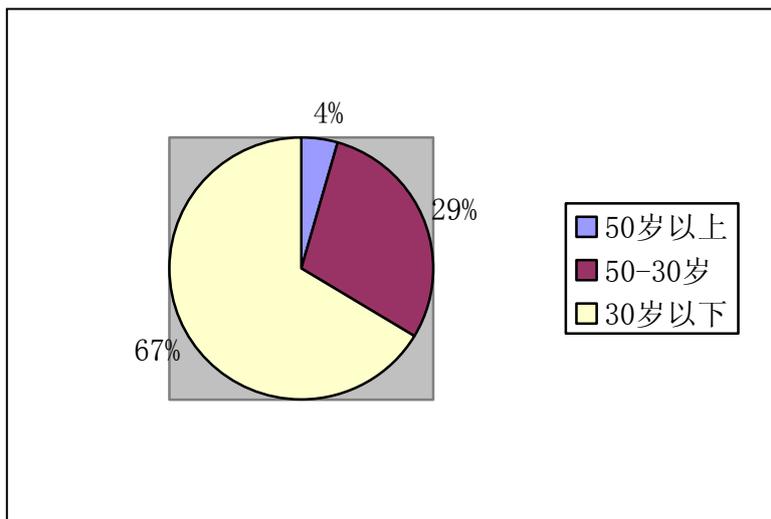
（二）按专业划分，技术人员 89 人，占比为 78%；技术服务人员 3 人，占比为 3%；销售人员 8 人，占比为 7%；财务和行政人员 13 人，占比为 12%；



(三) 按教育程度划分, 硕士以上学历 5 人, 占比为 4%; 本科学历 46 人, 占比为 41%; 专科学历 36 人, 占比 32%; 专科以下学历 26 人, 占比 23%:



(四) 按年龄划分, 30 岁以下 75 人, 占比为 67%; 30 岁至 50 岁 33 人, 占比为 29%; 50 岁以上 5 人, 占比为 4%:

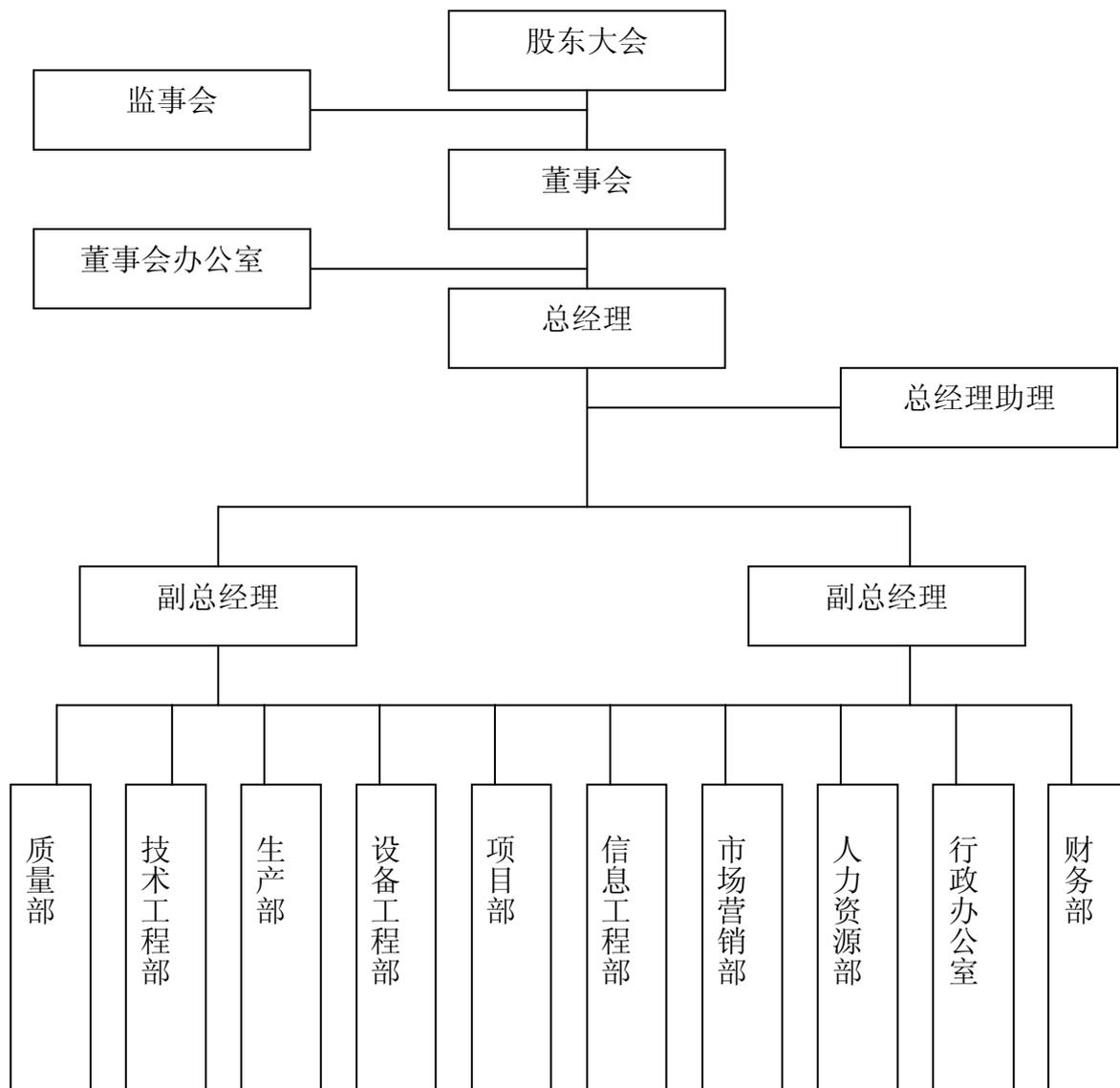


五、股权结构表

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	复旦微电子	2011.7527	64.90
2	卢尔健	237.1499	7.65
3	张志勇	205.6207	6.63
4	叶守银	145.7081	4.70
5	刘远华	124.6588	4.02
6	汪瑞祺	80.5603	2.60
7	牛勇	45.7262	1.48
8	祁建华	38.7058	1.25
9	施瑾	20.00	0.65
10	马庆容	17.00	0.55
11	刘后权	15.00	0.48
12	王元彪	11.00	0.36
13	汤雪飞	10.00	0.32
14	俞军	10.00	0.32
15	王苏	10.00	0.32
16	李清	10.00	0.32
17	王锦	9.7058	0.31
18	李桂华	9.00	0.29
19	郑昭蓉	6.7058	0.22
20	刘军	6.2353	0.20
21	方静	5.00	0.16
22	程君侠	4.00	0.13

23	马福斌	4.00	0.13
24	李蔚	4.00	0.13
25	纪兰花	4.00	0.13
26	刁林山	4.00	0.13
27	戴忠东	4.00	0.13
28	沈磊	4.00	0.13
29	梁小云	4.00	0.13
30	梅利军	4.00	0.13
31	丁琪琪	4.00	0.13
32	张艳丰	4.00	0.13
33	刘以非	4.00	0.13
34	方华	4.00	0.13
35	沈晓芳	2.2353	0.07
36	王亮	2.2353	0.07
37	曹治中	2.00	0.07
38	凌俭波	2.00	0.07
39	叶建明	2.00	0.07
40	徐惠	2.00	0.07
41	黄轶强	2.00	0.07
42	王静	2.00	0.07
43	张映	2.00	0.07
合计		3100.00	100.000

六、组织结构图



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、基本情况

(一) 公司董事基本情况

1、董事长：施瑾，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1956 年 8 月，1983 年毕业于复旦大学，工商管理硕士，副研究员。历任上海市计划委员会研究室主任、上海市工业投资咨询公司总经理、上海市工业投资财务管理公司董事长、上海市委研究室经济处副处长，1999 年 12 月加入复旦微电子任副总经理、2007 年 10 月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事长。2010 年 6 月 2 日，经公司创立大会暨第一次股东大会选举为公司董事，经公司第一届董事会第一次会议选举为公司董事长，任期三年。持有公司股份 20 万股；

2、董事：卢尔健，简历见本说明书第五章“三、主要股东情况：（三）其他主要股东简历 1”；

3、董事：张志勇，简历见本说明书第五章“三、主要股东情况：（三）其他主要股东简历 2”；

4、董事：王苏，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1953 年 12 月，1987 年毕业于华东师范大学，会计师。历任上海市商业投资公司基金部经理、财务部经理、上海太平洋商务信托公司财务总监，1998 年 7 月至今任复旦微电子执行董事、财务总监，2001 年 4 月起担任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事。2010 年 6 月 2 日，经公司创立大会暨第一次股东大会选举为公司董事，任期三年。持有公司股份 10 万股；

5、董事：俞军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 3 月，1990 年毕业于复旦大学，高级工程师。历任复旦大学集成电路设计研究室副主任，1998 年 7 月至今任复旦微电子任执行董事、副总经理，2001 年 4 月起担任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事。2010 年 6 月 2 日，经公司创立大会暨第一次股东大会选举为公司董事，任期三年。持有公司股份 10 万股。

(二) 公司监事基本情况

1、监事会主席：章倩苓，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1936年11月，1961年毕业于复旦大学，教授。历任复旦大学首席教授及博士生导师，复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室主任，现任复旦微电子非执行董事。国际集成电路业界著名学者，全国集成电路标准化分技术委员会，美国电气与电子工程师协会民生电子学会外国委员。2001年4月起担任上海华岭集成电路技术有限责任公司监事会主席。2010年6月2日，经公司创立大会暨第一次股东大会选举为公司监事，经公司第一届监事会第一次会议选举为公司监事会主席，任期三年。未持有公司股份；

2、监事：方静，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年10月，1995年毕业于上海立信会计学院，会计师。历任上海太平洋商务信托公司财务经理、上海复旦通讯股份有限公司财务总监，现任上海复旦微电子集团股份有限公司财务经理。2005年6月起担任上海华岭集成电路技术有限责任公司监事。2010年6月2日，经创立大会暨第一次股东大会选举为公司监事，任期三年。持有公司股份5万股；

3、监事（职工监事）：王锦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年1月，1990年毕业于江南大学。历任信息产业部电子五十八所工程师，2001年4月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司任市场营销部副经理。2010年5月31日，经公司职工大会选举为公司职工代表监事，任期三年。持有公司股份9.7058万股。

（三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理：张志勇，简历见本说明书第五章“三、主要股东情况：（三）其他主要股东简历2”；

2、副总经理：叶守银，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：610113196811262134，住址：上海市浦东新区长岛路825弄32号601室，生于1968年11月，1991年毕业于西安电子科技大学，高级工程师。历任信息产业部电子五十八所研究室副主任，2001年4月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司，一直担任副总经理职务，多项国家级重大科研项目负责人，国防科学技术进步奖二等奖，信息产业部科技进步二等奖、江苏省科技进步二等奖获得者。2001年4月至2010年5月还担任上海华岭集成电路技术有限责任公

司监事。2010年6月2日，由公司第一届董事会第一次会议任命为公司副总经理，任期三年。持有公司股份145.0781万股；

3、副总经理：刘远华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年8月，1986年毕业于西安电子科技大学，高级工程师。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师、信息产业部电子五十八所高级工程师，2001年4月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司任副总经理。2010年6月2日，由公司第一届董事会第一次会议聘任为公司副总经理，任期三年。持有公司股份124.6588万股；

4、总经理助理：汤雪飞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年1月，1994年毕业于后勤工程学院。曾任信息产业部电子第44所工程师，2004年1月任上海华岭集成电路技术有限责任公司总经理助理。2010年6月2日，由公司第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理助理，任期三年。持有公司股份10万股；

5、财务负责人：刘军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年4月，1989年毕业于上海立信会计学院，会计师。历任上海照相机三厂财务部经理，2003年3月任上海华岭集成电路技术有限责任公司财务经理。2010年6月2日，由公司第一届董事会第一次会议聘任为公司财务负责人，任期三年。持有公司股份6.2353万股。

（四）核心技术人员基本情况

1、核心技术人员：张志勇，简历见本说明书第五章“三、主要股东情况：（三）其他主要股东简历2”；

2、核心技术人员：叶守银，简历见本说明书第六章“一、基本情况：（三）公司高级管理人员基本情况2；

3、核心技术人员：汪瑞祺，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1952年2月，1987年毕业于上海第二工业大学，高级工程师。历任上海NEC计算机公司客户服务部经理、上海长江计算机服务公司副总经理，2001年4月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司任质量部经理。多次荣获上海市科技二等奖、三等奖，公司专利开发、软件著作权创作和重大科研项目的主要负责人之一。持有公司股份80.5603万股；

4、核心技术人员：牛勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1974年12月，1997年毕业于西安电子科技大学，工程师。历任无锡夏普电子元器件有限公司技术主管，2001年8月任上海华岭集成电路技术有限责任公司技术研发部经理，现任市场营销部经理。公司专利开发、软件著作权创作和重大科研项目的主要负责人之一。持有公司股份45.7262万股；

5、核心技术人员：祁建华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年12月，2000年毕业于南京航空航天大学。曾任职于中国人民解放军第四七二四工厂，2001年7月任上海华岭集成电路技术有限责任公司技术研发二部经理，现任技术研发部经理。公司专利开发、软件著作权创作和重大科研项目的主要负责人之一。持有公司股份38.7058万股。

二、与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议的情况

公司为保障公司核心利益不因上述人员离职而遭受损失，与董事、高级管理人员和核心技术人员以及在公司任职的监事签订劳动合同以及保密协议。

三、为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施

公司为稳定高管和核心技术人员除了加强企业文化建设，主要还采取通过原股东转让部分股权或定向增资形式逐步使高级管理人员和核心技术人员持有公司股份方式来稳定管理层及核心技术人员。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例（%）
施瑾	董事长	20.00	0.65
张志勇	董事兼总经理、 核心技术人员	205.6207	6.63
卢尔健	董事	237.1499	7.65
王苏	董事	10.00	0.32

俞军	董事	10.00	0.32
叶守银	副总经理、核心技术人员	145.7081	4.70
刘远华	副总经理	124.6588	4.02
汤雪飞	总经理助理	10.00	0.32
刘军	财务负责人	6.2353	0.20
章倩苓	监事会主席	0.00	0.00
王锦	监事	9.7058	0.31
方静	监事	5.00	0.16
汪瑞祺	核心技术人员	80.5603	2.60
牛勇	核心技术人员	45.7262	1.48
祁建华	核心技术人员	38.7058	1.25
合计		949.0709	30.61

第七章 公司业务和技术情况介绍

一、业务情况

公司是第一批国家鼓励的集成电路企业和高新技术企业，公司技术水平先进、装备一流，是具有自主技术创新研发和持续发展能力的国内先进的集成电路测试技术领先企业。

公司拥有超大规模集成电路测试系统、全自动芯片探针台等 100 多台(套)专业测试设备，拥有 4000 平米的研发和测试厂房，测试厂房净化级别达到 1000 级，建立了适应 12GHz 射频，1024PIN 以内数字集成电路、模拟集成电路和数模混合信号电路的测试，可测试 12 英寸、8 英寸、6 英寸等芯片，目前实际测试能力 2 万片 wafer/月、集成电路成品 2000 万颗/月。

公司自 2001 年成立以来，先后承担了国家集成电路技术研发和上海市科技攻关项目等多个国家和地方的集成电路测试技术开发项目，已为国内外 200 多家集成电路企业几百种集成电路产品提供了优质的测试服务。

公司建立的测试技术平台，能够满足数字逻辑电路、射频电路、混合信号电路、功率器件、电源管理电路以及模拟器件等不同类型集成电路产品的测试需求；针对集成电路产业升级，研究开发了测试模式、可测性结构分析与测试验证、结构测试、故障覆盖率测试、稳定性与可靠性测试、测试误差补偿等共性技术，在此基础上研发了 RF SOC、信息安全 SOC、数字音视频 SOC、网络通信 IC、汽车电子 IC、电源管理 IC 等不同芯片产品的测试技术，并实现了生产测试产业化。公司的测试平台可以覆盖目前国内 60% 以上的集成电路产品类型的测试，通过面向集成电路产业提供中立性的测试服务和设计验证服务，得到了业界上下游企业的广泛认同，树立了良好的测试技术服务形象。

公司承担了国家科技重大专项项目“极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用”及“集成电路测试公共服务平台建设”。通过国家科技重大专项的实施，公司完成了大生产测试共性关键技术研究，并实现了产业化测试；针对 RF、信息安全、数字音视频、数字通信、FPGA、FLASH、高速接口、高速高精度数模转换、IP 核 9 类 118 项产品的测试技术，完成了大规模测试线考核验证；

建立了极大规模集成电路生产测试线，测试技术指标达到：数模转换转换速率 330MSPS、14 位精度；串行数据速率 2.56Gbps、1024 个有效信号端口；满足了国家重点领域和重大项目中自主设计的集成电路芯片的测试需求；获得了一批研究和产业化成果，提升了公司的技术实力和在集成电路行业的影响力。

公司未来将进一步建设和完善芯片测试平台，继续专注于集成电路测试技术开发，立足上海，辐射全国，更好地为集成电路企业提供测试公共技术服务。

（一）公司的主营业务

公司的经营范围为：集成电路技术开发、应用、技术咨询，集成电路芯片及集成电路产品测试，探针卡、测试板设计，软件产品设计，国内贸易（除专项），从事货物与技术的进出口业务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

（二）公司的主要业务

公司作为独立的专业测试公司，为各类集成电路企业提供优质、经济和高效率的测试整体解决方案及多种测试增值服务，主要包括：测试程序开发、设计验证、晶圆测试以及集成电路成品测试。

测试程序开发是根据客户应用的要求，通过对芯片内部的模块进行研究，根据芯片的性能，选择符合该芯片测试需求的机型，编制测试计划，并根据测试计划完成芯片测试程序的编写和测试板的设计。测试程序是整个测试环节中重要的组成部分，集成电路的测试是由测试程序指挥测试系统完成的。

设计验证属于原型测试，一般是在设计完成后、批量生产前的检查测试分析，通过对芯片样品的测试完成性能、功能的详细分析，同时进行可靠性测试、失效分析，以改进设计或工艺。

晶圆测试（Wafer Test）属于生产测试，也称为集成电路中测，是利用探针台和测试机组成的测试系统对批量生产出的晶圆进行测试，通过探针对晶圆上每个独立的集成电路单元上的引线（Pad）接触，直接对晶粒输入信号或读取输出值，对芯片上的每颗晶粒测试的逐一检测，筛选出不良品并进行标识从而不进入后续的封装。部分不良品可以通过激光修复，部分芯片需进行数据录入或数据加密。测试完成后形成测试报告，反馈给设计公司或制造厂商进行分析，以作为未来设计效能与良率提升的参考依据。

成品测试（Final Test）也属于生产测试，也称为集成电路成测，是利用

机械手和测试机组成的测试系统对已经完成封装的集成电路芯片进行测试，以验证封装过程的正确性并保证每颗芯片能够达到设计要求的指标。

（三）公司经营模式

1、商业及盈利模式

公司所从事集成电路测试业务主要向集成电路设计、制造、封装以及应用等集成电路从业者提供能够满足其需求的、高效、优质、经济的集成电路测试软件开发、设计验证分析、生产测试和与之相关的技术服务，并以此获取经营收入及利润。

公司主要的商业模式是向客户提供集成电路测试服务业务和集成电路测试增值业务，其中：测试服务业务是对客户提供的测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，并向客户提供测试程序或最终的测试结果；测试增值业务是在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。

2、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，客户群体为集成电路产业链上各类型的企业，目前公司主要的客户类型为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业，随着公司测试技术和能力的不断提高，公司已经能够覆盖整个产业链。

二、主要产品的技术含量、可替代性

（一）公司主要产品的技术含量

1、测试共性技术

公司针对集成电路产业技术的升级，完成了测试模式、可测性结构分析与测试验证、结构测试、故障覆盖率测试、稳定性与可靠性测试、测试误差补偿等共性关键技术的研发工作。

2、产品测试技术

公司累计完成超过 500 种集成电路产品测试技术的开发，目前技术开发和测试能力的覆盖范围：

- 64 位多核 CPU、64 位 MCU、64 位 DSP，内部工作频率>900MHz，内嵌存储器（SRAM、FLASH、EEPROM 等）>256Mbit；

- 应用于信息安全、信息处理、通讯、数字处理、音视频等 SoC 芯片，内部工作频率>640MHz，内嵌存储器（SRAM、FLASH、EEPROM 等）>256Mbit，内嵌 AD/DA 和接口电路等；

- 600 万门~1000 万门级 FPGA，封装引脚数 1000pin，内部工作频率 >1000MHz；

- FLASH、EEPROM、EPROM、PROM、DRAM、SRAM 等存储器容量大于 256M X16bit；

- 低压差分信号（LVDS）高速接口芯片覆盖 USB2.0 通用串行总线、ATM 异步传输接口、IEEE1394（Firewire 火线接口）、LVDS 低电压差分信号接口、HDMI 高清多媒体接口等；

- 全系列 RFID 或加密 ID 等智能卡系列芯片。

3、五级多功能测试平台

公司引进了目前国际集成电路测试主流先进设备超过 100 台套，建立了 5 级多功能测试服务平台，包括：

- GHz 级新品测试分析平台；

- 200MHz 数模混合芯片性能与参数测试平台；

- 100MHz 数模混合新品以及 SoC 实时动态性能与参数测试平台；

- 50MHz 数字芯片性能与参数测试平台；

- 消费电子实时动态功能与参数测试平台。

同时测试平台具有的设计工作站和全套软件可以实现 EDA-ATE（设计-测试）自动衔接转换。

公司 5 级多功能测试平台是上海市支持的芯片测试技术服务平台。

公司的测试技术、测试能力处于国内先进水平，在 MPW（多项目晶圆）、IP（测试技术库）方面具备一定的优势，并能够保持与国际水平同步，结合公司的 5 级多功能测试平台，目前公司能够覆盖目前国内 60%以上的集成电路产品类型的测试，最大限度的满足用户不同的测试需求。

4、具备承担国家重大专项的技术能力

随着公司技术能力的提升以及国家对信息产业尤其是集成电路产业支持力度加大，近年来公司承担了多个国家重大科技专项，包括：“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”科技重大专项、“极大规模集成电路制造技术及成套工

艺”科技重大项目（02 专项）中的“极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用项目”以及“集成电路测试公共服务平台建设项目”。

（二）公司主要产品的可替代性

国内外从事集成电路测试的企业较多，互相之间均具有替代的可能，尤其是中国大陆地区以外的美国、中国台湾地区的测试企业，其测试理念、测试技术和测试设备优于大陆企业，国内有一半以上的芯片需要到大陆以外进行测试。

公司是中国大陆地区规模领先的集成电路独立测试企业之一，在测试技术、测试设备和测试能力上相比国内其他测试企业均具有一定的优势，国内部分高端芯片由于知识产权、国家安全等方面的因素通常会优先考虑国内测试企业，对于这类客户大陆以外的企业无法替代。此外，公司在部分测试技术方面的优势也是无法替代的。

三、所处行业基本情况

（一）行业概况

公司专业从事集成电路技术研究，测试软件开发、生产测试应用和芯片验证分析，属于集成电路产业四大主业（设计、制造、封装及测试）中的测试子行业，集成电路产业是国家重点鼓励发展的产业。

集成电路测试在集成电路产业链中有着举足轻重的作用，集成电路产品开发的成功与失败、产品生产的合格与不合格、产品应用的优秀与不良均需要验证与测试。例如在生产过程中，产品在制作中都会产生不良的个体，此时需要运用各种方法，检测那些在制造过程中由于物理缺陷而引起的不符合要求的样品。因此，集成电路测试也就成为集成电路产业链中不可缺少的工程之一，是不可或缺的重要组成部分，并贯穿于从集成电路设计、芯片制造、封装及集成电路应用的全过程，通过对产品进行严格的测试及筛选，以提供符合用户要求、质量合格的产品。

集成电路产业是目前世界上发展最快、最具影响力的产业之一，随着产业的发展，产业结构也不断的发生变化。早期集成电路产业链中以“全能型”企业即 IDM（Integrated Device Manufacturing 垂直整合制造）模式，测试往往作为集成电路企业的部门存在。上世纪七十年代开始，材料、设备业先后从产业链

中分离，随后封装、测试、制造、设计也相继分离，分离出多个“专而精”的细分子行业，并以此形成了产业集群。产业结构也演变成为在 IDM 公司继续发挥重大作用的基础上，形成了设计业、制造业、封装业和测试业独立成行的产业格局。集成电路测试企业从以往 IDM 的部门、制造业或封装业生产工序中渐渐分离成为集成电路产业链中的独立一环。

1、行业管理体制

行业行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为工业行业和信息化产业的监督管理，针对集成电路产业负责制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

行业协会是中国半导体行业协会，中国半导体行业协会是由从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的相关的企、事业单位自愿结成的行业性、全国性、非营利性的社会组织，是中国集成电路的行业自律管理机构。行业协会在工信部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。行业协会下设：集成电路分会、封装测试分会、设计分会等。公司是集成电路分会和封装测试分会会员。

2、行业政策

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家给予了高度重视和大力支持，为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境，促进集成电路产业十年的快速发展。

2000 年 6 月，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号），该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。

2000 年 9 月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），制定了鼓励集成电路产业发展的若干税收政策。

2002年10月，财政部、国家税务总局发布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70号），出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。

2005年3月，财政部、信息产业部、国家发改委发布《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132号），由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。

2005年10月，国家发改委、信息产业部、税务总局、海关总署发布《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）》（发改高技[2005]2136号），规范国家鼓励的集成电路企业认定工作，进一步贯彻落实国务院有关政策及其配套优惠政策。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，纲要提出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键，并将“突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平”作为信息产业重要的发展思路。同时纲要将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（01专项）、极大规模集成电路制造技术及成套工艺（02专项）作为16个重大专项的前两位，并在科技投入、税收优惠、金融支持、知识产权保护等方面提出了政策和措施。

2006年3月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，提出了集成电路、软件和新型元器件是“十一五”期间重点发展的基础性核心产业。

2006年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020年国家信息化发展战略》，提出了提高信息产业竞争力，加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。此外，发展战略提出了“在集成电路（特别是中央处理器芯片）、系统软件、关键应用软件、自主可控关键装备等涉及自主发展能力的关键领域，瞄准国际创新前沿，加大投入，重点突破，逐步掌握产业发展的主动权”的关键信息技术自主创新计划。

2006年8月，信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，提出了“在集成电路、软件和关键元器件、电子专用设备仪器 and 电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破，掌握一批关键技术，拥有一批核心专利与标准。集成电路自给率显著提高”的发展目标，并将集成电路作为未来5~15年的重点发展产业。

2007年1月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业（第十三项）。

2008年1月，原信息产业部编制并颁布了《集成电路产业“十一五”专项规划》，制定了“十一五”期间集成电路产业的发展思路与目标、重点任务以及相应的政策措施。

2008年2月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），进一步制定了针对集成电路企业所享受的所得税优惠政策。

2009年4月，国务院通过《电子信息产业调整和振兴规划》，提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标，并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施，加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。

2010年10月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），提出了“着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业”，集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，是国家未来重点发展的战略新兴产业。

2011年1月，国务院出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），再次提出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。

2012年2月，工信部印发了《集成电路产业“十二五”发展规划》，制定了

集成电路产业发展的指导思想、基本原则和发展目标、主要任务和发展重点以及政策措施。

2012年5月，财政部、国家税务总局出台了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，继续制定了针对集成电路企业所享受的所得税优惠政策。

2012年7月，国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号），将新一代信息技术作为战略性新兴产业和国民经济支柱产业，并在其中的电子核心基础产业中明确提出“大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势”。在重大工程之一的高性能集成电路工程再次提出“提高先进封装工艺和测试水平”。

3、行业基本情况

集成电路是信息产业的基础和核心，集成电路产业是国民经济的关键基础性和战略性行业，在国民经济中占据着十分重要的地位。

集成电路（Integrated Circuit, 简称 IC）是 20 世纪 60 年代初期发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成具有一定功能的电路所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。集成电路所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面发展。

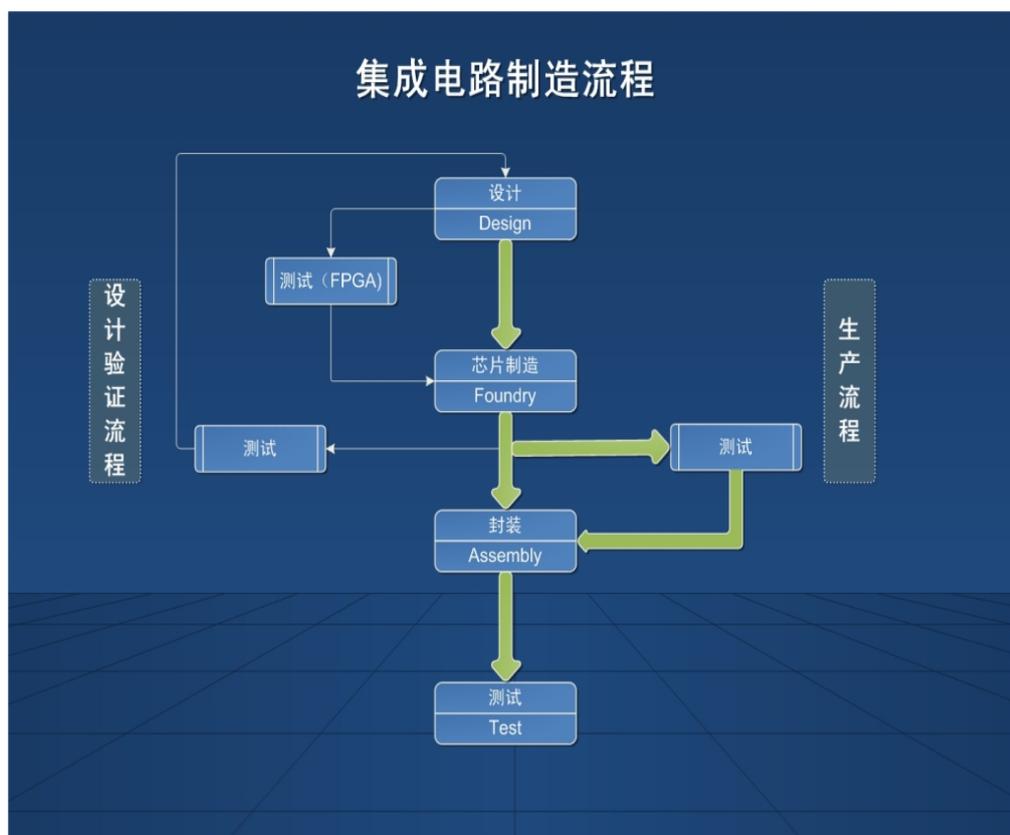
集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类；集成电路也可以按集成度高低的的不同分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路以及极大规模集成电路等；此外，集成电路还可以按照制作工艺、导电类型、用途、应用领域及外形分为不同的种类。

集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强，倍增效应

大，在推动经济发展上发挥着重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出，各国对该行业都极为重视，发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展，使得这一行业的竞争非常激烈，激烈的竞争也使得集成电路技术得以不断更新。

集成电路行业属于典型的资本密集型、技术密集型和人才密集型产业，并且规模经济特征明显。集成电路行业是需要不断投入巨额资金、大量人力的产业，设备费用和研发费用都非常大。随着集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。自集成电路发明以来，芯片产量和性能成千万倍提高，而芯片平均售价却不断下调，所以只有依靠大规模生产，实现规模经济，才能降低单位成本，实现盈利。

集成电路产业链分为电路设计、晶圆制造、芯片封装以及测试等环节（如下图所示）。



自发明集成电路至今几十年以来，集成电路产品从小规模集成电路逐步到目前的极大规模集成电路，整个集成电路产品的发展经历了从传统的板上系统

(System-on-board) 到片上系统 (System-on-a-chip, SoC) 的过程, 世界集成电路产业为适应技术的发展和市场需求, 其产业结构经历了三次变革。

第一阶段——以加工制造为主导的 IC 产业发展阶段

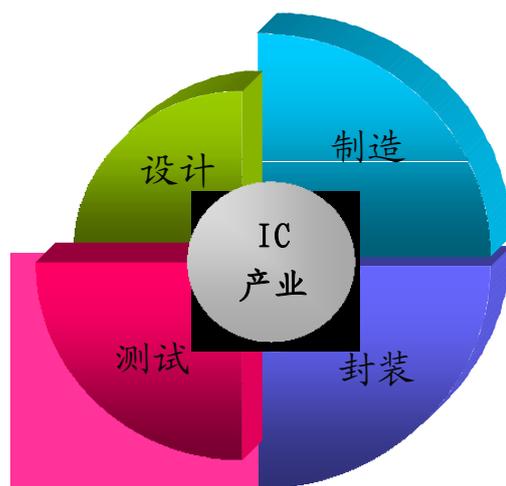
上世纪七十年代, 集成电路的主流产品是微处理器、存储器以及标准通用逻辑电路。这一时期集成电路制造商 (IDM) 在行业中充当主要角色, 集成电路由制造商 (IDM) 自行设计, 并由自己的生产线加工、封装, 测试后的成品芯片自行销售, 集成电路测试与半导体工艺密切相关, 并且仅作为附属部门而存在。集成电路产业仅处在以生产为导向的初级阶段。

第二阶段——标准工艺加工线与设计公司格局出现

上世纪八十年代, 集成电路的主流产品为微处理器 (MPU)、微控制器 (MCU) 及专用 IC (ASIC)。行业中的无生产线的集成电路设计公司 (Fabless) 与标准工艺加工线 (Foundry) 相结合的方式开始成为集成电路产业发展的新模式。

第三阶段——IDM 与“四业分离”并存产业结构形成

上世纪九十年代开始, 随着互联网的兴起, 集成电路产业跨入以竞争为导向的阶段, 产业竞争由原来的资源竞争、价格竞争转向人才知识竞争、密集资本竞争。此时, 越来越庞大的集成电路产业体系并不有利于整个产业发展和壮大, 集成电路产业结构向高度专业化转化成为一种趋势, 开始形成了设计业、制造业、



封装业、测试业独立成行的局面 (如下图所示)。

集成电路产业从此进入制造商 (IDM) 继续发挥重大作用, 设计业、制造业、封装业和测试业“四业并举”的产业格局。

目前，国际上最大的半导体公司仍多为 IDM 企业，例如世界前 5 名半导体公司英特尔、三星、德州仪器、东芝和意法半导体都是典型的 IDM 企业。与此同时，也涌现出独立的 IC 设计公司、晶圆制造企业、封装测试企业及独立测试企业。

集成电路测试业在整个产业链中处于服务的位置，贯穿在集成电路设计、芯片制造、封装以及集成电路应用的全过程，测试是集成电路产业链中重要的一环，具有技术含量高、知识密集的特点。集成电路测试同时服务于集成电路设计企业、制造企业和封装企业，在产业链中具有重要的作用，从芯片设计和生产的过程来看如果没有测试，这个产业链是不完整的甚至是断裂。

中国大陆地区集成电路产业机构与世界发达国家不同，所具有的特点是 IDM 制造商不发达，但却拥有世界一流的 Foundry 工厂，同时拥有超过 500 家设计公司。中国大陆地区已经成为全球最大和发展速度最快的集成电路市场，随着技术进步和产业提升，我国新进的设计、制造和封装企业对于先进测试技术的共同需求越来越大。但是由于先进集成电路测试技术含量高、知识密集，能够独立承担专业测试服务的公司寥寥无几，无法满足众多产业化测试需求。另外，测试能力也一直是我国集成电路自主设计发展的制约因素。在快速发展的集成电路产业中，测试相对于集成电路设计、制造和封装是最薄弱的一环。

随着产业的发展，集成电路产业已经进入了高性能 CPU、DSP 和 Soc 时代，同时随着产品进入 90nm、65nm、45nm 工艺后，随着芯片的日益复杂和性能不断提高，高端产品的测试验证和生产费用越来越高，为集成电路测试业带来巨大发展原动力和商机，专业化的独立测试企业迎来了巨大的市场发展机遇。

（二）行业竞争格局

集成电路测试行业作为集成电路产业的重要一环，其生存和发展与集成电路产业息息相关。世界先进的集成电路测试设备技术，基本掌握在美国、日本等集成电路产业发达国家厂商手中；而美国、欧盟以及日本作为传统的半导体行业领先地区拥有绝对的优势地位，其在集成电路测试理念以及测试技术均处于国际领先地位。而我国台湾地区作为 Foundry 模式的优势地区，拥有超过 30 家的测试企业，其独立测试企业无论在数量、企业规模上也具备一定的优势。

根据台湾工研院 IEK 统计，2010 年全球集成电路独立测试产值约 55.41 亿

美元，中国台湾集成电路测试业产值占全球比超过 70%，持续维持全球专业委外测试产业第一地位，短期内没有任何国家或地区能取代中国台湾地区在世界集成电路测试行业的地位，第二、三名则分别为新加坡与美国，具体如下表所示：

2008~2010 年集成电路测试行业全球排名 单位（亿美元）

排名	2008			2009			2010		
	国家或地区	产值	全球市场占有率	国家或地区	产值	全球市场占有率	国家或地区	产值	全球市场占有率
1	中国台湾	27.85	60.70%	中国台湾	24.1	63.70%	中国台湾	39.47	71.20%
2	新加坡	7.19	15.70%	新加坡	5.85	15.50%	新加坡	8.06	15.90%
3	美国	3.19	7.00%	美国	2.61	6.90%	美国	3.25	6.40%

资料来源：中国台湾工研院 IEK

中国大陆地区集成电路测试产业起步较晚，最早的独立测试企业成立至今也不过十余年，可以规模化生产的专业集成电路测试企业在十家左右。目前，大陆地区测试产能主要集中在集成电路制造企业的测试车间以及封装企业的测试业务部门，其中封装企业拥有国内大部分的集成电路测试产能。由于国内集成电路测试行业在规模、装备和技术方面与国际水平存在一定的差距，目前国内除了涉及国家安全的芯片以外，约 60%以上的高端芯片必须交由大陆地区以外的企业完成。

近年来，集成电路测试产业发展势头良好，但是独立测试占整个集成电路产业规模的比例仍然较小，与集成电路产业链中的制造商（IDM）、设计企业、制造企业、封装企业相比，独立测试企业普遍规模偏小。但是随着集成电路行业尤其是国内集成电路行业的发展，国内对于集成电路测试的需求将不断扩大，同时随着国家对独立测试行业的认可和重视，集成电路测试行业将有着广阔的发展空间。

（三）行业内的主要企业及其市场份额

集成电路测试产业属于集成电路的细分子行业，国内产业主管部门、行业协会未对其进行专项统计，因此无法获得权威的行业统计数据；大陆地区除了北京确安科技股份有限公司（原北京华大泰思特半导体检测技术有限公司）在代办股份转让系统挂牌外，并无其他企业上市，因此无法获得行业主要企业的市场份额。

行业内具有代表性的企业主要有：京元电子股份有限公司（中国台湾地区）、

北京确安科技股份有限公司、华润赛美科微电子（深圳）有限公司、无锡泰思特测试有限责任公司，通过公开资料获得了场地规模、晶圆测试能力、成品测试能力等部分其产能数据，具体情况如下表所示：

名称	测试能力			行业地位
	场地规模	晶圆测试能力	成品测试能力	
京元电子股份有限公司（台湾）	约 18 万平米 测试车间	40 万片/月	4 亿颗/月	全球最大的独立集成电路测试企业
北京确安科技股份有限公司	1000 平米	8000 片/月（8 英寸） 3000 片/月（4~5 英寸）	1000 万颗/月	北方地区最大的独立集成电路测试企业
华润赛美科微电子（深圳）有限公司	数千平米	8 万片/月（4~8 英寸）	1 亿颗/月	珠三角地区最大的独立集成电路测试企业
无锡泰思特测试有限责任公司	500 平米	8000 片/月（3-8 英寸）	-	大陆地区最早设立的独立集成电路测试企业
上海华岭集成电路技术股份有限公司	4000 平米	2 万片/月（6-12 英寸）	1000 万颗/月	大陆地区规模领先的独立集成电路测试企业之一、长三角地区最大的独立测试企业之一

注：以上数据均来源于公开资料，并不保证数据的准确性。其中：京元电子股份有限公司为 <http://www.kyec.com.tw>、北京确安科技股份有限公司来自于其报价转让说明书、华润赛美科微电子（深圳）有限公司为 <http://www.crmsz.com>、无锡泰思特测试有限责任公司为 <http://www.wxtest.cn>。

公司是大陆地区规模领先的独立集成电路测试企业之一，也是长三角地区最大的独立测试企业之一，与大陆地区其他主要测试企业相比，公司是为数不多可以提供 12 英寸晶圆测试的企业。但是同全球最大的独立集成电路测试企业——京元电子股份有限公司相比，公司无论在场地面积、设备规模、测试能力等各个方面均存在较大的差距，与国内集成电路产业中的设计、制造和封装等其他企业相比，公司在资本规模、资产规模、收入规模等方面也存在较大的差距，公司在集成电路产业链中属于中小型企业。

（四）进入本行业的主要障碍

集成电路测试行业进入壁垒主要表现在以下几个方面：

1、技术壁垒

集成电路测试行业属于技术密集型行业，集成电路行业作为高科技行业遵循摩尔定律保持持续高速发展，作为与之配套的集成电路测试行业同样需要保持能够满足新产品、新技术的测试需求，这就需要测试企业必须保持长时间、大规模和同步的研发，如果无法跟上集成电路的发展步伐将会被市场所淘汰。

2、资本壁垒

集成电路测试行业也属于资本密集型行业，先进的测试设备大部分都需要从国外进口，单台测试设备的采购价格往往在几十万甚至上百万美金，为了保持产能和测试能力的先进性，就需要不断投入，对资本的需求非常大。

3、人才壁垒

集成电路测试行业同时也是人才密集型行业，集成电路行业属于高科技产业，技术往往掌握在人才手中，集成电路测试技术对人才的要求极高，由于测试覆盖了从设计到制造以及封装的整个过程，因此也要求集成电路测试工程师不仅需要掌握测试技术，同时需要掌握芯片设计、制造及封装知识，而我国测试工程师的培养相对比较薄弱，能够掌握专业技术的人才有限，目前还很难满足行业的整体需求。

4、行业经验壁垒

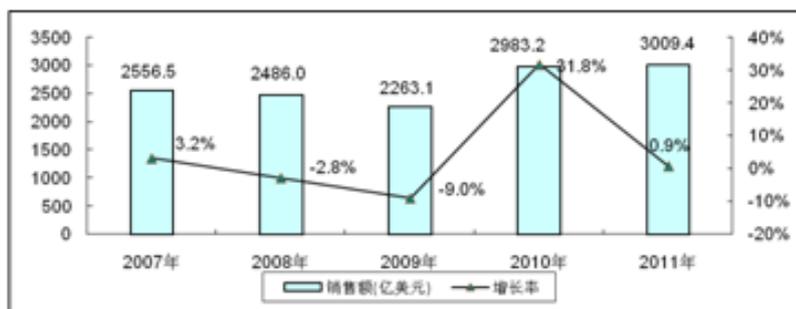
集成电路测试是一个需要丰富的测试经验积累，测试产品的类型越多，测试企业能够积累的经验也就更丰富，对于新产品的响应速度也将更快、可靠性也会更高，对客户的吸引力也往往更强，有助于测试企业获得良好口碑，获得长期的合作机会。

5、认证壁垒

由于集成电路行业具有单个晶圆价值高、技术含量高等特点，企业在与上下游企业合作前往往需要对其进行严格的认证，例如企业技术水平、测试能力、质量管理体系以及可靠性等，这类认证过程往往要求高、时间长，并且一旦认证后就会锁定合作关系，增加了新进企业获得订单的难度。

（五）市场供求状况及变动原因

根据中国半导体行业协会的统计，2007年-2011年5年间，全球半导体市场复合增长率为3.32%，2011年全球半导体市场规模为3009.4亿美元，仅实现微弱增长0.88%。经济环境的不景气以及通货膨胀的抑制，直接导致了其对电子整机需求的减弱。此外，半导体厂商在金融危机期间逆市投资扩大产能的市场效应也集中于2011年释放，市场需求放缓、制造产能过剩直接导致了产品价格的大幅下降。

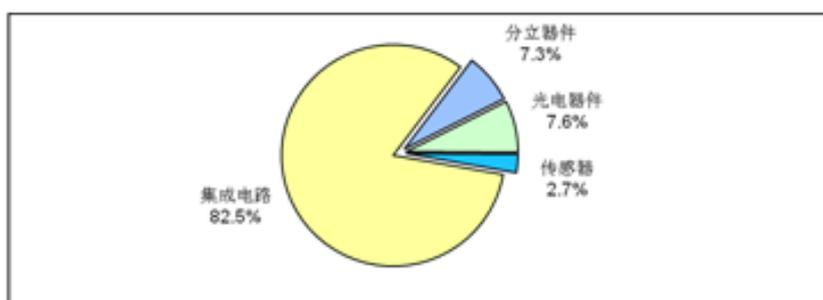


2007-2011年全球半导体市场规模与增长

数据来源：中国半导体行业协会

2011年全球半导体产品结构比重与2010年相比稍有变化，分立器件和传感器的份额持续上升。从发展速度来看，在全球半导体市场低迷的情况下，传感器市场快速增长达17.43%，这也主要得益于各种传感器在众多电子产品中的广泛推广。分立器件市场增速为10.94%，集成电路则出现微弱负增长，市场价格下降是主要原因。

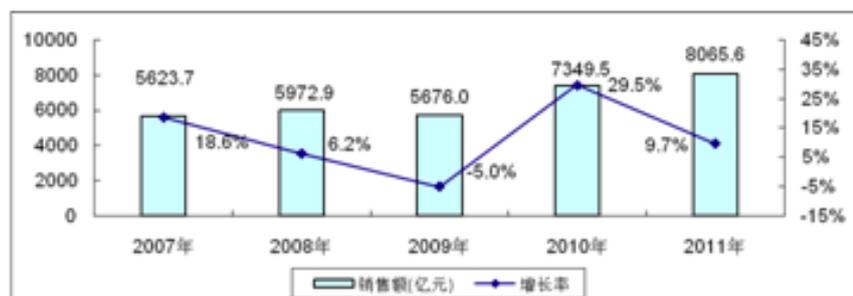
2011年全球半导体市场产品结构如下图所示：



2011年全球半导体市场产品结构

数据来源：中国半导体行业协会

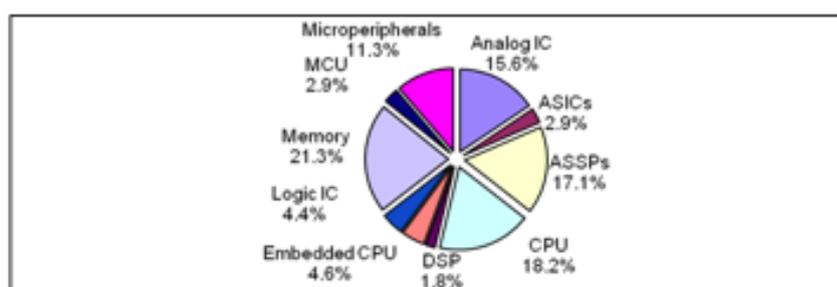
在国内外多种因素的制约下，2011年中国集成电路市场销售额实现了9.7%的小幅增长，达到创纪录的8065.6亿元，市场增速仍高于全球市场。



2007年-2011年中国集成电路市场销售情况

数据来源：中国半导体行业协会

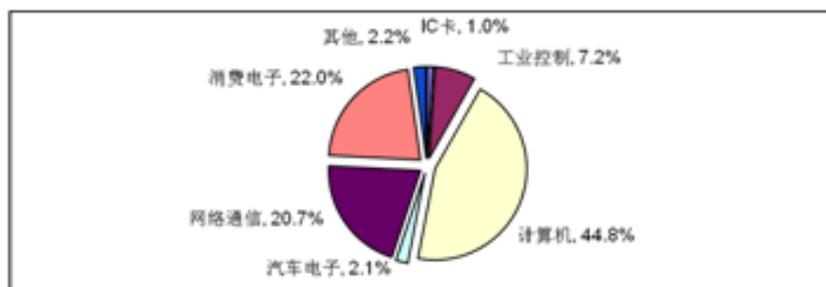
在产品结构方面,存储器仍然是份额最大的产品,2011年市场份额达21.3%,与2010年相比,市场份额下降近3个百分点。究其原因,2011年在存储器产品结构中占较大市场份额的DRAM产品遭遇价格的大幅下跌,主流PCDRAM产品价格一度下跌幅度超过50%以上,导致2011年下半年各大内存厂商纷纷减产内存产能。与DRAM产品市场状况截然不同的是,nand flash产品则在智能手机、Pad、MID等产品迅速普及的带动下,市场销量大增,产品价格整体呈现平稳缓跌。在此消彼长的作用下,2011年存储器市场出现3.1%的市场衰退。此外,ASSPs随着各种专用高度集成芯片的出现,市场增速加快,市场份额有所提高;CPU的增长则主要得益于2011年中国在计算机,特别是笔记本产品的产量快速增长。



2011年中国集成电路产品结构

数据来源：中国半导体行业协会

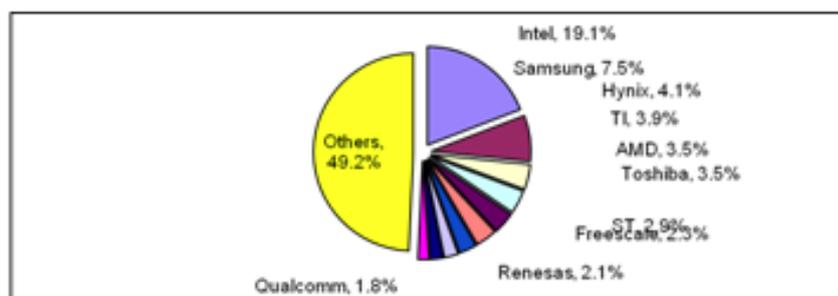
应用结构方面,计算机、通信和消费电子仍然是中国集成电路市场最主要的应用市场,三者合计共占整体市场87.5%的市场份额。从发展速度来看,IC卡应用市场取代之之前快速增长的汽车电子应用市场,成为2011年引领中国集成电路市场增长的首要细分市场。计算机类集成电路市场2011年延续了前几年的增长态势,市场增速为9.2%。



2011年中国集成电路应用结构

数据来源：中国半导体行业协会

在品牌结构方面，英特尔仍然毫无悬念地占据中国集成电路市场排名首位。海力士虽然仍位居市场排名第三，但其市场增速衰退 12.7%，内存产品价格大幅下跌是主要原因。瑞萨则受日本大地震对其 MCU 生产，特别是汽车电子用 MCU 生产的影响，市场增速出现 2.8% 的小幅衰退。高通以超过 30% 的市场增速跻身中国集成电路市场排名前十，其在移动终端产品领域的市场占有率迅速提升是确保公司业绩的主要原因。



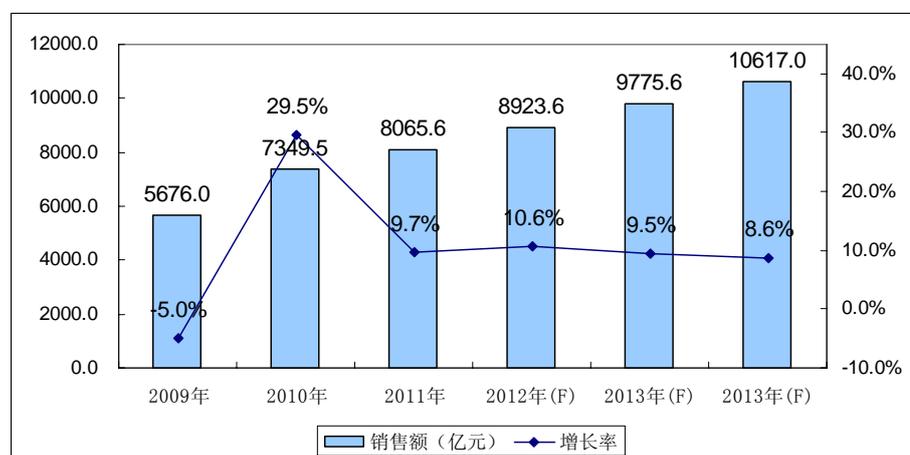
2011年中国集成电路品牌结构

数据来源：中国半导体行业协会

未来几年，若全球经济不出现大幅波动，平稳小幅的增长方式将是未来几年中国集成电路市场的发展趋势，市场未来几年的增速将保持在 9% 左右，市场发展的主要驱动力仍然主要来自 PC、手机、液晶电视以及其它产量较大的电子产品。此外，未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一，物联网、云计算、新能源、半导体照明、医疗电子和安防电子等新兴领域的发展，将为中国集成电路市场带来新动力，MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强，这些等新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动半导体市场的发展。

根据中国半导体行业协会的预测，从 2012 年开始，中国集成电路市场将保

持稳步增长，但市场的发展速度将不会再现前几年的高速增长态势，平稳增长将成为未来中国集成电路市场发展的主要形式，未来 2012 年-2014 年三年中国集成电路市场的增长幅度将分别达到 10.6%、9.5%和 8.6%，中国集成电路市场规模在 2014 年将有望突破 10000 亿元人民币。



2012-2014 年中国集成电路产业规模及增长预测

数据来源：中国半导体行业协会

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

公司所处行业为国家行业政策鼓励和重点支持发展的行业，近几年，国家已出台了一系列政策，对该行业进行支持，这些政策促成了国内电子信息产业及集成电路产业的快速发展，详细情况请参考本节前文“二、所处行业的基本情况”。根据国家发展规划，预期未来国家还将出台更多针对集成电路产业的优惠，这将有力地推动我国集成电路产业的健康稳步发展。

（2）集成电路产业持续向中国转移

近年来，笔记本电脑、数码相机、通讯产品等信息产品的生产基地都大规模向中国转移，中国已经成为世界电子信息产品最大最重要的生产基地之一。而我国人才、土地、劳动力成本等优势依然明显，越来越多的国际集成电路企业扩大在中国的生产规模。集成电路产业持续向国内转移，带动了国内集成电路产业的整体产业规模和技术水平。在国内垂直代工模式下，集成电路设计、制造和封

装企业无论从规模还是数量上都保持快速增长的态势,这将大幅带动国内集成电路测试行业的快速发展。

(3) 市场需求带动集成电路产业发展

集成电路是信息产业的核心,计算机、通信、消费电子等电子信息产品的市场需求驱动了集成电路产业的发展,尽管在 2009 年我国集成电路产业出现了衰退,但是 2010 年强劲反弹后,产业进入平稳发展状态。可以预计的未来几年我国信息产业仍将保持稳定增长态势,这将拉动集成电路产业的发展。

2、不利因素

(1) 集成电路测试行业规模仍然较小

虽然独立测试行业和企业逐步被市场所接受,由于国内独立测试企业数量、规模还不能够满足行业需求,大量的测试仍在制造和封装企业中完成,而高端新品中超过 60%还需送往海外测试。相对于国内的集成电路设计、制造和封装企业而言,测试企业规模较小,独立测试行业相对于设计、制造和封装行业规模也非常小,行业规模和企业规模的弱小在一定程度上会制约行业的发展。

(2) 技术水平仍与国际先进水平存在一定差距

尽管集成电路产业已经成为我国的支柱产业之一,但是集成电路行业尤其是测试行业的技术水平与国际先进水平还存在一定的差距。目前,在集成电路行业中的高端技术和高端产品的市场份额仍然由行业国际巨头所占据,其中集成电路测试行业国内企业仍以中低端测试为主,无论从技术水平、测试规模和测试装备上发达国家企业均具有一定的优势,这些均对行业的发展造成了一定的负面影响。

(3) 集成电路装备制造产业较为薄弱

支撑我国半导体产业的集成电路装备制造业规模小、技术水平落后、创新能力不足,尚不具备为集成电路制造、封装以及测试产业提供充分配套的能力。

国产集成电路测试设备主要集中在低端和半商业化应用领域。而高端的测试设备主要依赖于国际主流的测试设备厂商,例如泰瑞达、惠瑞捷(测试机)以及东京精密、东京电子、美国 EG 公司(探针台),装备过于依赖于进口在一定程度上会限制国内集成电路测试行业的发展。

（七）行业周期性、季节性、区域性特征等

1、周期性

在周期性方面，受“摩尔定律”等芯片发展规律的影响，集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，人们称这种周期性的变化为“硅周期”，通常一个“硅周期”为4-5年。经过长时间的高速增长以后，增速趋缓属于行业的正常调整。目前国内集成电路行业已逐步摆脱国际金融危机影响，出现稳步反弹的迹象，凸现了市场周期性复苏迹象，预计未来几年，国内IC行业有望进入新的周期性平稳增长阶段。

2、区域性

在区域性方面，中国大陆地区集成电路产业具有明显的区域性特征，目前电子产品制造业和分销商主要集中在珠三角、长三角、环渤海地区，集中的原因是这些地区工业化进程开始的时间较早，在物流运输、上下游产业配套、政策支持、人力资源方面具有一定的先发优势。全国集成电路产业近90%的销售收入集中于以上三个地区，长三角、环渤海地区、珠三角占全国集成电路总销售收入的比重分别为55.8%、22.7%和8.7%，合计为87.2%。

长三角地区是国内最主要的集成电路制造基地，在国内集成电路产业中占有重要地位，全国55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近50%的集成电路设计企业集中在该地区。

目前，长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。”

3、季节性

在季节性方面，由于部分消费类电子产品受节假日影响较大，消费类电子产品又是集成电路重要的应用产品，因此集成电路产业具有一定的季节性特征。但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势，因此目前而言，集成电路行业整体上季节性特征并不如以往明显。

四、公司面临的主要竞争情况

（一）公司在行业中的竞争地位

上海华岭集成电路技术股份有限公司是国内成立较早的专业化独立第三方

集成电路测试企业，是国家第一批鼓励的集成电路企业和高新技术企业。公司自 2001 年成立以来，先后承担了国家科技重大专项和上海市科技攻关项目等多个国家和地方的集成电路测试技术开发项目，在行业内积累了丰富的测试经验和客户资源。

经过近十年的发展，公司的集成电路测试平台能够覆盖目前国内 60% 以上的集成电路产品，公司无论在技术水平、测试装备、测试能力上均领先于国内同类企业，已经成为大陆地区规模领先的独立集成电路测试企业之一。

公司是具有自主技术创新研发和持续发展能力的国内先进的集成电路测试技术领先企业，目前正在积极推进极大规模集成电路测试技术及产业化应用，进一步建设和完善芯片测试生产线，继续专注于集成电路测试技术服务，做到立足上海，辐射全国。

（二）自身的竞争优势及劣势

1、自身的竞争优势：

（1）技术优势

公司历来都非常重视对于研发的投入，近年来研发费用占公司主营业务收入的比重均超过 20%，通过人力、物力和财力的投入，公司在技术全面性方面已经远超国内竞争对手，公司具备多项目晶圆测试技术（MPW 即一个晶圆上测试多个产品）、测试技术库（IP）等技术优势。同时，作为业内领先企业，公司近年来承担了多个国家重大科技专项，包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”专项项目 1 项、“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”专项项目（02 专项）2 项——“极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用项目”和“集成电路测试公共服务平台建设项目”。

公司通过承担多个国家科技重大科技专项，进一步保持和提升公司的测试技术实力和在集成电路行业的影响力，保证公司在技术方面做到国内领先，并在某些特定产品测试技术方面不断缩小同国际先进技术的差距。

（2）团队优势

公司拥有一支不断追求创新和进步的管理与研发团队。公司的管理和研发团队中拥有国内第一代大规模集成电路自动测试技术研发人员、国家科技部、工信部专家库专家，同时拥有一支包括多位教授级研究员和高级工程师的 70 多人

的研发团队。

（3）行业经验优势

公司通过十年的发展和积累，已经为国内外 200 多家集成电路企业几百种集成电路产品提供了优质的测试服务，测试平台可以覆盖目前国内 60% 以上的集成电路产品类型的测试，得到了业界上下游企业的广泛认同，树立了良好的测试技术服务形象。

（4）地域优势

公司地处国内集成电路产业最为发达的长三角地区，区域内拥有大量的集成电路测试企业，集成电路设计、制造和封装产业规模居国内领先地位，公司熟悉全国市场，同时能够做到快速响应，这能够为公司带来大量业务机会。同时作为本土企业，公司能够更加容易获得涉及国家信息安全的产品测试业务。

2、自身的竞争劣势：

（1）规模劣势

作为集成电路独立测试企业，公司虽然成立时间较早，在同行业中规模排名靠前，但是国内集成电路测试行业整体起步较晚，虽然公司属于国内成立较早的集成电路测试企业之一，公司初期的发展主要依靠自身的积累，公司无论在资本规模、设备规模以及测试产能规模等方面与国外优势企业均有一定差距。

（2）配套服务劣势

作为独立的测试企业，虽然公司能够提供全方面的测试解决方案，但是相对于制造和封装企业而言独立测试企业产业配套不全面，在开拓测试服务市场方面存在一定的劣势。

（三）采取的竞争策略和应对措施

1、公司采取的竞争策略：

秉承“创新、进取”的经营理念，奉行“稳健、务实”的经营风格，致力于为顾客提供高品质、低成本、高效快速的集成电路测试技术服务。

充分利用现有技术、设备、人才、质量和管理等方面的优势，通过集成电路产业链的纵向拓展、横向联合，不断提升测试能力和产品附加值，不断巩固企业核心竞争力，力求将企业打造成国内首屈一指且具有国际影响力的集成电路产业化测试基地。

2、公司未来将从以下几个方面提升公司核心竞争力：

第一，加强团队建设，在自身培养和储备人才的同时，引进国内外技术、营销和管理方面的能人贤士；

第二，跟踪国际先进技术，开发高端集成电路测试共性技术和产品技术，保持与国际先进水平的同步；

第三，增加国际主流测试设备投资，迅速扩大高附加值产品的测试市场份额，保持国内测试能力的领先地位，提高抵御风险的能力；

第四，大力开发市场，特别是发展同知名集成电路设计企业、晶圆制造厂和封装厂的策略联盟关系，关注他们对于晶圆测试和成品测试不同的需求。

五、知识产权和非专利技术

（一）专利技术

序号	类型	名称	权利号	取得方式	权利范围	有效期限
1	实用新型	一种抗干扰异步修调晶圆测试用探针卡	ZL200920069027.0	原始取得	全部权利	2019.3.18
2	发明专利	一种抗干扰异步修调晶圆测试方法	ZL200910047761.1	原始取得	全部权利	2029.3.18
3	发明专利	熔丝类晶圆修调参数的方法	ZL201010216507.2	原始取得	全部权利	2030.6.30

注：上述三项专利权所有人为上海华岭集成电路技术有限责任公司，目前公司已在申请更名为上海华岭集成电路技术股份有限公司

此外，公司向中国国家知识产权局申请 29 项专利，其中含 2 项国际专利，上述申请均已获得受理，正在申请专利如下：

序号	名称	申请号	申请日	申请人
1	FPGA 配置器件的 ATE 测试方法	201010123404.1	2010.3.12	上海华岭集成电路技术有限责任公司
2	FPGA 配置文件的生成方法	200910200706.1	2009.12.24	上海华岭集成电路技

				术有限责任公司
3	安全芯片的测试方法与系统	201010241690.1	2010.7.30	上海华岭集成电路技术股份有限公司
4	测试适配板受理通知书	201210236900.7	2012.7.9	上海华岭集成电路技术股份有限公司
5	测试文件压缩方法	201110127104.5	2011.5.17	上海华岭集成电路技术股份有限公司
6	高速通信总线芯片端口特性测试方法	201110127102.6	2011.5.17	上海华岭集成电路技术股份有限公司
7	集成电路测试优化方法及其测试装置	201210207009.0	2012.6.21	上海华岭集成电路技术股份有限公司
8	集成电路功能测试中的匹配特定波行的方法	201010269738.X	2010.8.31	上海华岭集成电路技术股份有限公司
9	具有物理隔离特征的测试装置	20111012105.X	2011.5.17	上海华岭集成电路技术股份有限公司
10	抗氧化修整熔丝的方法	201010216521.2	2010.6.30	上海华岭集成电路技术有限责任公司
11	模数转换器数字地与模拟地连接状况的测试方法	201010543343.4	2010.11.12	上海华岭集成电路技术股份有限公司
12	实时监控探针测试利用率的方法	201010600189.X	2010.12.21	上海华岭集成电路技术股份有限公司
13	瞬时电流的测试系统与方法	201010269755.3	2010.8.31	上海华岭集成电路技术股份有限公司
14	探针测试实时监控系统	201010600397.X	2010.12.21	上海华岭集成电路技术股份有限公司
15	探针接触电阻在线测量方法	201010216484.5	2010.6.30	上海华岭集成电路技术有限责任公司
16	探针卡	201010575210.5	2010.12.6	上海华岭集成电路技术股份有限公司
17	特殊封装芯片的测试方法	201010571098.8	2010.12.2	上海华岭集成电路技术股份有限公司
18	特殊封装芯片的测试系统	201010571438.7	2010.12.2	上海华岭集成电路技术股份有限公司
19	提高芯片电压测试精度方法	201210206527.0	2012.6.21	上海华岭集成电路技术股份有限公司

20	芯片引脚调整装置	201210236892.6	2012.7.9	上海华岭集成电路技术股份有限公司
21	信号波形控制方法	201010543339.8	2010.11.12	上海华岭集成电路技术股份有限公司
22	信号发生器	201010543345.3	2010.11.12	上海华岭集成电路技术股份有限公司
23	寻找 FPGA 配置文件与 CLB 块配置资源的映射方法	201010216532.0	2010.6.30	上海华岭集成电路技术有限责任公司
24	一种探针测试线路及其设计方法	201010216492.X	2010.6.30	上海华岭集成电路技术有限责任公司
25	用于半导体器件测试的测试装置	201210206597.6	2012.6.21	上海华岭集成电路技术股份有限公司
26	用于无时钟电路的标签芯片的测试方法及测试装置	201210236898.3	2012.7.9	上海华岭集成电路技术股份有限公司
27	源复用测试方法	201110127116.8	2011.5.17	上海华岭集成电路技术股份有限公司
28	PCT110592US 具有物理隔离特征的测试装置	13504548	2012.4.27	张杰
29	测试文件压缩方法	13504622	2012.4.27	徐惠

注：第 1、2、10、15、23 和 24 项申请的申请人为上海华岭集成电路技术有限责任公司，公司正在申请将专利申请人变更为上海华岭集成电路技术股份有限公司；第 28 和 29 项申请为向美国申请的国际专利，依照美国法律，专利申请人只能是发明人，故申请人为公司两名员工。为保障公司权益，公司已与两名员工达成一致意见确认两项专利系职务发明，故由员工自愿出具声明，保证待获得专利权后即按美国法律无偿转让给上海华岭集成电路技术股份有限公司。

（二）软件著作权

序号	名称	权利号	取得方式	权利范围	有效期限	其他权属证明文件
1	SINOIC TESTING SOFTWARE V1.0	2003SR8235	原始取得	全部权利	2052.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200287 号）
2	华岭四位微控制器测试软件 V1.0	2004SR12428	原始取得	全部权利	2054.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202329 号）
3	华岭 MCU 系列产品测试软件 V1.0	2005SR01036	原始取得	全部权利	2054.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200698 号）

4	GAL20V8 现场可编程器件测试软件 V1.0	2007SR00072	原始取得	全部权利	2056.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201205006 号）
5	华岭 8K 位电可擦除只读存储器测试软件 V1.0	2007SR01730	原始取得	全部权利	2056.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200962 号）
6	华岭安全芯片 SOC 测试软件 V1.0	2007SR01729	原始取得	全部权利	2056.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200960 号）
7	华岭熔丝修调技术软件 V1.0	2007SR00087	原始取得	全部权利	2056.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202323 号）
8	华岭 P150 实时图形软件 V1.0	2008SR03606	原始取得	全部权利	2057.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200702 号）
9	华岭 P200 图形软件 V1.0	2008SR03607	原始取得	全部权利	2057.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200961 号）
10	华岭 T200 图形软件 V1.0	2008SR03608	原始取得	全部权利	2057.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201201134 号）
11	华岭数字电视 SOC 测试软件 V1.0	2008SR37784	原始取得	全部权利	2058.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202315 号）
12	华岭数字音视频 SOC 芯片测试软件 V1.0	2008SR38047	原始取得	全部权利	2058.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202324 号）
13	华岭 FPGA 测试软件 V1.0	2009SR02344	原始取得	全部权利	2058.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200700 号）
14	华岭高速数字视频解码芯片测试软件 V1.0	2009SR041298	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202312 号）
15	华岭高速数字图像处理芯片测试软件 V1.0	2009SR041342	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202316 号）
16	华岭高速以太网通信芯片测试软件 V1.0	2009SR042085	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202313 号）
17	华岭高性能数字视频编码芯片测试软件 V1.0	2009SR042865	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202319 号）

18	华岭 CAN 总线通信芯片测试软件 V1.0	2010SR001175	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200705 号）
19	华岭 16 位高性能模数转换芯片测试软件 V1.0	2010SR001190	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200543 号）
20	华岭 6 缸汽车发动机功率驱动芯片测试软件 V1.0	2010SR001194	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200968 号）
21	华岭数字信号处理芯片测试软件 V1.0	2010SR001196	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202325 号）
22	华岭高速 SerDes 通信芯片测试软件 V1.0	2010SR001201	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202322 号）
23	华岭 FPGA 配置芯片测试软件 V1.0	2010SR001203	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200699 号）
24	华岭嵌入式高速模数转换芯片测试软件 V1.0	2010SR001329	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202310 号）
25	华岭蓝牙 RF SOC 芯片测试软件 V1.0	2010SR001330	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202309 号）
26	华岭高性能 DSP 芯片测试软件 V1.0	2010SR001348	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202317 号）
27	华岭手机用蓝牙芯片测试软件 V1.0	2010SR001353	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202311 号）
28	华岭信息安全芯片嵌入式 flash 测试软件 V1.0	2010SR003557	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202327 号）
29	华岭高效功率控制芯片测试软件 V1.0	2010SR003558	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202314 号）
30	华岭蓝牙 2.0 芯片测试软件 V1.0	2010SR003560	原始取得	全部权利	2059.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202321 号）
31	华岭高性能工业处理器芯片测试软件 V1.0	2010SR030130	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202318 号）

32	华岭 10 万门 FPGA 测试软件 V1.0	2010SR034069	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200967 号）
33	华岭安全信息处理芯片测试软件 V1.0	2010SR034068	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200966 号）
34	华岭低功耗移动通信电源监控芯片测试软件 V1.0	2010SR033862	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200965 号）
35	华岭国密芯片测试软件 V1.0	2010SR027959	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202320 号）
36	华岭 60 万门 FPGA 测试软件 V1.0	2010SR030129	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200542 号）
37	华岭 3C 中央处理器芯片测试软件 V1.0	2010SR027960	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201205004 号）
38	华岭多功能物理复接芯片测试软件 V1.0	2010SR033864	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200964 号）
39	华岭 ATM 层处理器芯片测试软件 V1.0	2010SR027760	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200703 号）
40	华岭税控加密芯片测试软件 V1.0	2010SR047171	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202326 号）
41	华岭高精度能量计量芯片测试软件 V1.0	2010SR047464	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200963 号）
42	华岭 CMMB 核心芯片测试软件 V1.0	2010SR057672	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200701 号）
43	华岭图形处理 DSP 芯片测试软件 V1.0	2010SR062794	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201202328 号）
44	华岭 32 位嵌入式微处理器芯片测试软件 V1.0	2010SR062798	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明（软著变补字第 201200704 号）
45	华岭卫星图像传输芯片测试软件 V1.0	2011SR002068	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
46	华岭单芯片 FM 立体声收音机芯片测试	2011SR009268	原始取得	全部权利	2060.12.31	--

	软件 V1.0					
47	华岭单线传输点光源 LED 芯片测试软件 (V1.0)	2011SR002072	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
48	华岭 LED 驱动芯片测试软件 (V1.0)	2011SR007430	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
49	华岭 100 万门 FPGA 测试软件 V1.0	2011SR007647	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
50	华岭卫星低噪块控制芯片测试软件 V1.0	2011SR007431	原始取得	全部权利	2059.12.31	--
51	华岭 VPN 加速器芯片测试软件 V1.0	2011SR007457	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
52	华岭串行存储器芯片测试软件 V1.0	2011SR001959	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
53	华岭高速模数转换芯片测试软件 V1.0	2011SR001761	原始取得	全部权利	2059.12.31	--
54	华岭 RFID 芯片测试软件 V1.0	2011SR055731	原始取得	全部权利	2060.12.31	--
55	华岭高速视频数模转换器芯片测试软件 V1.0	2011SR034382	原始取得	全部权利	2061.12.31	--
56	华岭 24bit 高精度模数转换器芯片测试软件 V1.0	2011SR034175	原始取得	全部权利	2061.12.31	--
57	华岭 3G 双模终端数字基带处理器测试软件 V1.0	2011SR085691	原始取得	全部权利	2061.12.31	--
58	华岭信息安全控制器芯片测试软件 V1.0	2011SR085696	原始取得	全部权利	2061.12.31	--
59	华岭移动电视芯片测试软件 V1.0	2010SR030131	原始取得	全部权利	2060.12.31	计算机软件著作权登记事项变更或补充证明 (软著变补字第 201202308 号)
60	华岭射频 5G 接收机芯片测试软件 V1.0	2012SR067797	原始取得	全部权利	2062.12.31	--
61	华岭 UID 芯片数据检测软件 V1.0	2012SR068078	原始取得	全部权利	2062.12.31	--
62	华岭串行通信控制器芯片测试软件 V1.0	2012SR068157	原始取得	全部权利	2062.12.31	--
63	华岭加密移动存储控制 SOC 芯片测试软件 V1.0	2012SR068158	原始取得	全部权利	2062.12.31	--

64	华岭射频模拟锁相环芯片测试软件 V1.0	2012SR068917	原始取得	全部权利	2062.12.31	--
65	华岭高性能编解码处理芯片测试软件 V1.0	2012SR071819	原始取得	全部权利	2062.12.31	--

注：上表所载“计算机软件著作权登记事项变更或补充证明”均是将该无形资产所有权人由上海华岭集成电路技术有限责任公司变更为上海华岭集成电路技术股份有限公司。

以上软件著作权为公司自主研发取得，不存在任何纠纷。

（三）商标

公司目前已经取得两项商标专用权，所使用的商品类别分别是 40 类和 42 类。

名称	权利号	类型	权利人	取得方式	有效期限
“华岭科技”+图形	第 7380884 号	商 标 /40 类	上海华岭集成电路技术有限责任公司	原始取得	2020.10.20
“华岭科技”+图形	第 7380885 号	商 标 /42 类	上海华岭集成电路技术有限责任公司	原始取得	2021.7.6

注：“华岭科技”+图形：



六、核心技术情况

（一）核心技术来源和取得方式

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织和具有丰富经验的研发人员，每年均投入大量的人力、物力和财力进行集成电路测试技术的研发，近年来每年投入的研发费用均超过当年主营业务收入的 20%，公司针对不同集成电路产品的测试解决方案均为自主研发，主要产品所采用的核心技术及专有技术均为自主研发。

（二）自主技术占核心技术比重

公司所有技术均为自主研发取得，核心技术全部是自主技术。

（三）核心技术的先进性

公司具备多项目晶圆测试技术（MPW 即一个晶圆上测试多个产品）、测试技术库（IP）等技术优势。同时，作为业内领先企业，公司近年来承担了多个国家重大专项等高端项目，包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”项目、“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”项目（02 专项）中的“极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用项目”和“集成电路测试公共服务平台建设项目”。

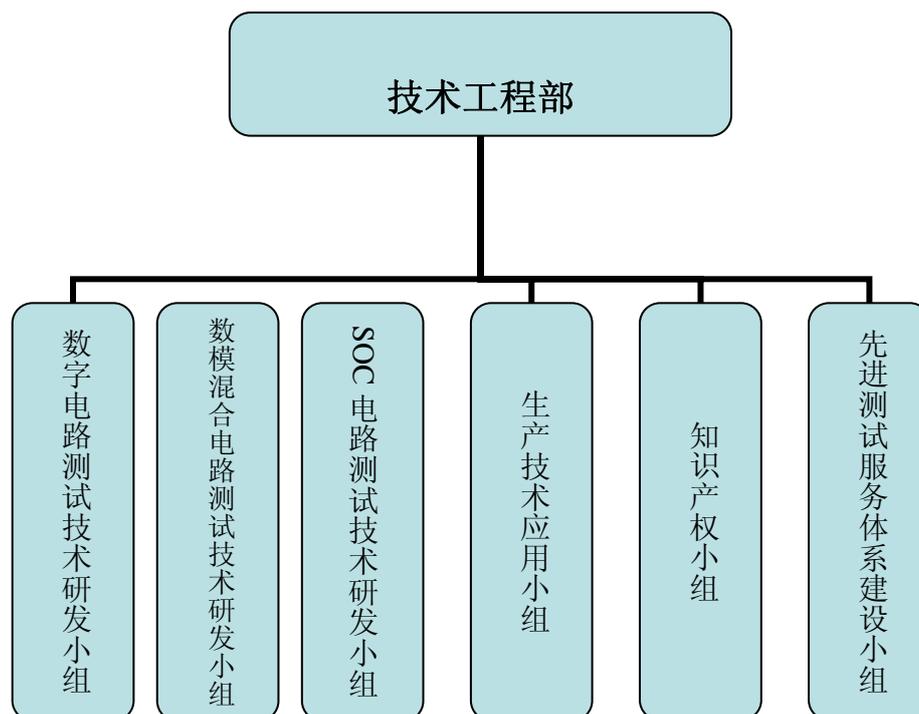
公司通过 02 专项的实施，完成了大生产测试共性关键技术研究，并实现了产业化测试；针对 RF、信息安全、数字音视频、数字通信、FPGA、FLASH、高速接口、高速高精度数模转换、IP 核 9 类 118 项产品的测试技术，完成了大规模测试线考核验证；建立了极大规模集成电路生产测试线，测试技术指标达到：数模转换转换速率 330MSPS、14 位精度；串行数据速率 2.56Gbps、1024 个有效信号端口；满足了国家重点领域和重大项目中自主设计的集成电路芯片的测试需求；获得了一批研究和产业化成果，提升了公司的技术实力和在集成电路行业的影响力。

公司核心技术具有一定技术含量，在国内同行业中目前保持领先地位。

七、研发情况

（一）研究开发机构设置及研究人员构成

公司主要的研究开发机构为公司技术工程部，下设以下几个小组：数字电路测试技术研发小组、数模混合电路测试技术研发小组、SOC 电路测试技术研发小组、生产技术应用小组、知识产权小组以及先进测试服务体系建设小组。



数字电路、数模混合电路、SOC 电路测试技术研发小组分别负责各自领域内的数字电路、数模混合电路以及 SOC 电路等高端通用产品测试技术、高速电路测试技术以及系统及封装电路测试技术的开发；生产技术应用小组负责大生产线建设、大生产测试共性技术开发以及大生产测试技术的应用；知识产权小组负责知识产权申请、知识产权共享体系建设以及质量管理体系建设；先进测试服务体系建设小组负责虚拟测试工厂运行与维护、测试数据库建设和维护以及质量管理体系和市场体系。

公司作为服务于整个集成电路产业链的企业，测试技术水平必须与集成电路行业中的设计、制造和封装技术水平保持同步，因此要求公司必须具备超强的研发能力，使公司在技术上做到国内领先、国际同步。公司成立至今，已经累计完成了超过 500 种的集成电路产品测试技术开发，包括：

- 数十种内嵌存储器、CPU、MCU、DSP、数字逻辑、模拟和混合电路等 IP 的信息安全、通讯、数字处理、音视频 SoC 芯片；
- 32 位 CPU、MCU、DSP；
- USB2.0、ATM 等低压差分信号（LVDS）高速接口芯片；
- PFGA、GAL、FLASH、EEPROM、EPROM、PROM、DRAM、SRAM 等芯片，CPU RF 卡、RFID、加密 ID 等职能卡芯片；
- 电源管理芯片；

- 锁相环 PLL，ADC/DAC 、CODEC 等；
- 65nm、90nm、0.13 μ m、0.18 μ m 标准单元库、输入输出库和 IP 核新品；
- SOI 集成电路芯片等。

此外，公司也紧跟国家集成电路产业政策，公司承担了 02 专项中极大规模集成电路制造装备接成套工艺——极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用项目。

公司拥有超过 70 人的研发队伍，其中包括：国内第一代大规模集成电路自动测试技术研究人员；国家科技部“863”专家库专家；教授级研究员 2 人，高级工程师 4 人。

公司主要研发人员详见本说明书第六章“一、基本情况”：“（四）核心技术人员基本情况”。

2、研发费用投入情况

公司的研发费用主要用于集成电路测试技术的开发，公司非常重视对于研发的投入，为了保持公司的测试技术与测试能力能够满足集成电路行业的要求，每年都会投入大量的人力、物力和财力进行集成电路测试技术的研发工作，从而保持公司技术的领先地位，2010 年至 2012 年 1-6 月公司的研发投入均超过主营业务收入的 20%，分别为 22.56%、21.22%和 25.47%。

2010 年至 2012 年 1-6 月，公司研发投入情况见下表：

年度	研发投入总额（元）	占主营业务收入比重（%）
2010 年	9,978,529.58	22.56%
2011 年	11,309,476.86	21.22%
2012 年 1-6 月	6,389,874.76	25.47%

八、供应商及前五名客户情况

1、主要供应商情况

公司 2010 年-2012 年 1-6 月前五名供应商统计如下：

2010 年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
----	------	---------	---------

1	深圳市视美泰通讯技术有限公司	3,483,840.20	11.80%
2	无锡中微腾芯有限公司	3,420,000.00	11.59%
3	Toolster., Ltd	2,476,714.16	8.39%
4	株式会社东京精密	2,367,687.59	8.02%
5	上海精毅电子科技有限公司	2,312,255.32	7.83%
合计		14,060,497.27	47.63%

2011年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	无锡中微腾芯有限公司	6,689,550.00	15.31%
2	上海晶毅电子科技有限公司	5,482,153.86	12.55%
3	泰瑞达日本公司	5,015,259.00	11.48%
4	株式会社东京精密	4,662,723.75	10.67%
5	上海张江集团有限责任公司	3,986,503.90	9.12%
合计		25,836,190.51	59.13%

2012年1-6月供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占当期采购比例
1	泰瑞达亚洲公司	8,406,532.92	35.50%
2	泰瑞达日本公司	6,283,156.32	26.53%
3	无锡中微腾芯有限公司	2,866,500.00	12.11%
4	株式会社东京精密	2,519,189.76	10.64%
5	上海张江集团有限责任公司	1,313,530.26	5.55%
合计		21,388,909.26	90.33%

2010年、2011年、2012年1-6月公司前五大供应商占比较高，其中2010年、2011年在50%左右，2012年上半年超过了90%。公司的主要供应商是集成电路测试设备厂商或其代理商，为了提高公司测试能力，公司每年均投入大量的资金用于采购国际主流和高端的集成电路测试设备，其中测试机厂商泰瑞达、惠瑞捷，探针台厂商东京精密、东京电子、美国EG公司在各自领域中代表了全世界最先进、最高技术水平。2012年1-6月，公司集中采购了部分测试设备，因此前五大供应商占当期采购量较高。虽然集成电路测试设备的主流供应商数量不

多，但是这些公司之间的竞争也比较激烈，各个公司的设备也各有特点，目前没有任何一家公司占据垄断地位。公司在设备采购时主要考虑自身的业务发展需要选择不同的厂商，公司在实际采购过程中也没有一家供应商超过 50%的情况，因此公司不存在对少数供应商依赖的情况，也不会由此产生经营风险。

公司不存在对一个或几个主要供应商存在依赖关系。

此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

2、主要客户情况

公司 2010-2012 年 1-6 月销售客户前五名统计如下：

2010 年度销售客户前五名

序号	销售客户	销售额（元）	占主营业务收入比重
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	19,827,155.17	44.83%
2	深圳市国微电子股份有限公司	4,068,580.46	9.20%
3	北京圣涛平试验工程技术研究有限责任公司	3,688,226.00	8.34%
4	无锡中微腾芯电子有限公司	3,341,880.34	7.56%
5	上海复控华龙微系统技术有限公司	2,453,854.70	5.55%
合计		33,379,696.67	75.48%

2011 年度销售客户前五名

序号	销售客户	销售额（元）	占主营业务收入比重
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	23,429,692.62	43.95%
2	无锡中微腾芯电子有限公司	8,002,000.00	15.01%
3	深圳市国微电子股份有限公司	4,577,765.41	8.59%
4	上海集成电路技术与产业促进中心	3,500,000.00	6.57%
5	上海复控华龙微系统技术有限公司	1,605,653.85	3.01%
合计		41,115,111.88	77.13%

2012 年上半年销售客户前五名

序号	销售客户	销售额（元）	占主营业务收入比重
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	11,676,345.72	46.54%
2	无锡中微腾芯电子有限公司	4,754,716.98	18.95%
3	深圳市国微电子股份有限公司	2,579,805.28	10.28%
4	苏州国芯科技有限公司	1,792,452.83	7.14%
5	创毅微电子（香港）科技有限公司	1,058,289.13	4.22%
合计		21,861,609.94	87.13

公司前五大客户占比较高，2010年、2011年和2012年1-6月分别达到了75.47%、77.13%和87.14%，主要原因是复旦微电子占公司主营业务收入较高，最近两年一期分别为44.83%、43.95%和46.54%。复旦微电子及其控股子公司作为关联方目前是公司最大的客户，但公司的业务并不依赖于复旦微电子。复旦微电子是国内最大的集成电路设计企业之一，其芯片测试业务首先会考虑国内大陆地区具备较高测试能力和较大测试规模的控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司；同时，公司作为复旦微电子的控股子公司，测试产能也会优先考虑复旦微电子的需求，公司与复旦微电子之间是相互合作的关系，不存在对其的依赖。公司未来将继续通过持续的产能扩张以及市场开拓来逐步降低复旦微电子所占比重。

因此，公司不存在对一个或几个主要客户存在依赖关系。

此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来两年发展计划

（一）公司未来两年业务发展目标

公司秉承“创新、进取”的经营理念，奉行“稳健、务实”的经营风格，致力于为顾客提供高品质、低成本、高效快速的集成电路测试技术服务。

公司将专注于集成电路测试的主业发展，不断研发新技术，同时充分利用现有技术、设备、人才、质量和管理等方面的优势，通过集成电路产业链的纵向拓展、横向联合，不断提升测试能力和产品附加值，不断巩固企业核心竞争力，力求将企业打造成国内首屈一指且具有国际影响力的集成电路产业化测试基地。

公司未来两年的总体业务目标是：持续加大高端 RF、SoC、SIP 等测试技术研发和 12 英寸晶圆测试线装备的投入，提升高附加值业务的比重，保持公司晶圆测试业务在国内的行业领先地位；进一步发展集成电路成品测试，努力完善业务结构和产业布局。公司计划到 2014 年，成为国内首家实现全年营业收入超过 1 亿元的集成电路专业测试公司，同时税后利润达到 2000 万元以上。

（二）未来两年发展计划

1、技术研发与创新计划

测试技术的研发和创新能力是公司立足市场的核心竞争力。近年来，随着国内集成电路整个行业技术水平的不断提升，市场对测试技术的要求也越来越高，公司已经确定以高端集成电路测试共性技术和产品技术的研究为重点发展方向的技术发展目标。具体来说就是，重点发展制造线宽 32 至 90 纳米的 12 英寸晶圆测试技术，重点发展信息安全、移动通信、数字音视频、图像处理、RFSoc 等中高端集成电路产品的测试技术和物联网芯片测试技术，进一步推广远程在线芯片测试应用技术，探索建设全国性的芯片测试云计算网络，争取在上述领域中，每年新增 20 项以上具有产业化应用价值的的软件著作权、专利等知识产权。

公司计划到 2014 年，完成集成电路产业化测试基地的初步建设，形成完整的、覆盖国内重点产品方向的规模化、产业化的 12 英寸大规模集成电路测试生

产线，满足国内集成电路产业链的大多数企业和科研院校，在集成电路测试技术开发、测试应用解决方案、新产品测试验证分析和集成电路产业化测试等方面的需求，实现创新型企业的目标。

2、测试公共服务平台建设计划

公司将按照国家《集成电路产业“十二五”发展规划》的要求，利用承担国家重大研发专项之契机，推动两个平台，即国家级集成电路测试公共服务平台以及上海市集成电路测试公共服务平台的建设，广泛地开展国内亟需的测试共性技术的研究，有针对性的进行国家重点支持的产品测试技术的开发，为国内各类集成电路企业和科研院校提供快速、高效、优质的集成电路测试技术服务。

通过两个平台的建设，企业的技术实力能够在国家倡导的产学研用并进的研发模式下再上一个台阶，提高企业的行业知名度，在发挥服务于社会之平台功能的同时，企业积累大量潜在的商业客户，为产业化生产打下基础。

公司计划在两年内，将自身打造成技术先进、设备一流、功能齐全、国内屈指可数的顶尖芯片测试公共服务平台，完成国家赋予的引领行业技术发展的责任。

3、市场拓展与营销计划

公司将专注于集成电路测试市场的业务拓展，未来的营销策略将重点发展高端的产品客户，兼顾中低端产品市场。中低端产品作为养线产品虽然利润率不高，但可以最大限度提高公司的产能利用率；中端量大测试产品作为企业主要业务之一，目前为公司提供稳定的收入与利润来源；而高端测试产品由于测试技术只有为数不多的公司所掌握，因此虽然获取难度大但附加值较高，这部分业务比重的多少直接决定了公司的整体盈利能力，也是公司努力发展的方向。

公司的晶圆测试一直以来占据了绝大多数业务份额，单一的业务结构虽然令公司主营业务突出，同时也对公司业务收入增长构成了瓶颈。公司已经逐渐加大力度拓展高价值集成电路成品测试业务，成品测试虽然毛利率没有晶圆测试那么高，但是也有稳定的客户需求，从长期来看对于公司营业收入的稳定增长具有积极的作用。作为测试主业的补充和发展，公司正在积极尝试开展集成电路产业链上与测试相关的衍生业务。

公司目前的主要客户包括多家排名国内前十位的 IC 设计公司，也包括多家

排名国内前十位大型晶圆制造或 IC 封装企业。公司将紧紧围绕“顾客满意度高于一切”的经营宗旨，通过提供高品质、低成本、高效快速的服务，重点发展同这些客户的长期战略合作伙伴关系，力争在两年内培育 3 个以上千万级大客户，显著提高公司芯片测试业务的市场份额。

在营销网络的建设方面，公司第一步将有选择地考察国内集成电路产业发展的重点区域，包括国家科技部批准的北京、上海、深圳、杭州、无锡、成都、西安等 7 个集成电路设计产业基地和国家认定的北京、上海、天津、苏州、宁波等 5 个国家集成电路产业园，选择一到多个城市设立分支机构进行业务拓展，第二步，视业务发展和市场需求情况，设立台湾等业务办事处。

4、人力资源计划

芯片测试业是人才密集型行业。为保证公司的长期可持续发展，公司一方面将努力维持核心员工团队之稳定，多层次、多方位、不同形式地加强员工培训工作，不断提高公司现有员工团队的整体素质，另一方面，本公司将根据业务发展的实际需要积极吸纳国内外优秀人才，特别是技术、营销、管理方面的人才。

为减少人才的流失，公司计划继续施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策，为他们量身定制职业发展规划，公司将适时的加大力度推行员工持股计划，增加核心员工对企业的归属感，此外，公司亦将不断策划其他管理和激励措施，以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。

到 2014 年，公司计划新吸纳各类人才 70-100 人，其中技术、营销、管理人员所占比例将达到 7 成以上，届时公司全部员工人数将在目前基础上翻一番。

5、内部控制制度的完善计划

公司将依据《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》的有关规定，进一步完善法人治理结构，加强内部控制，健全管理制度来提升公司的管理水平。公司将加强董事会的职能建设，逐步完善董事会战略、审计、薪酬与考核专业委员会等组织机构，在适当时候引入独立董事，促进公司建立科学、高效的决策系统。

公司将严格执行《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等内部管理制度，依据新《企业会计准则》科学地进行企业财务管理及核算，因地制宜地调整公司的组织结构，建立和完善目标管理体系及绩效考核体

系，建立健全激励约束机制，以保证公司经营目标的实现，促进公司整体管理水平的提高。

6、融资计划

公司将根据企业发展规划和市场发展需要，在控制财务风险、实施稳健财务政策的基础上，适时考虑通过定向发行股票引进战略投资者、申请银行贷款、发行债券、申请国家财政扶持资金等多种方式进行融资，以保证公司打造集成电路测试产业化基地之战略发展规划有关技术研发、设备更新、市场营销拓展和收购兼并等资本运作的资金需求。

7、收购兼并计划

未来两年内，公司为谋求进一步发展，将根据实际需求围绕集成电路测试的核心主业，积极寻求合作伙伴和投资项目，公司将视竞争环境和市场变化，在充分考察论证的基础上，相应做出收购兼并等资本运营安排。

二、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素

（一）政策风险

近年来，国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策，若未来国家政策发生变化，降低对集成电路行业的扶持力度，则可能对公司的主营业务产生重大影响；同时，政府可能减少项目投入，若公司无法获得政府资金方面的支持，则将对公司发展速度产生一定影响。

公司对策：

国家《集成电路产业“十二五”发展规划》指出，集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑，其战略地位日益凸显。国家 2006 年发布的《2006-2020 年国家信息化发展战略》和《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等文件均将集成电路作为重点发展的战略性新兴产业，国家科技重大专项作为《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》的重要组成部分将持续到 2020 年，由此可见国家政策在可预见的未来基本不会发生重大变化。

公司通过近几年承担各类政府项目，初步完成了技术、设备、客户的积累，

具备了一定的抵御政府政策变动风险的能力；同时公司也做好积极应对措施，如进一步加大研发力度、提高技术含量、降低生产成本、扩大市场份额，已降低政策风险对公司造成的不利影响。”

（二）新技术更新风险

公司是一家集成电路测试企业，测试技术研发能力是公司最重要的核心竞争力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋加快，公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市场需求的变化，未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面临的重要风险。

公司对策：

公司通过承担国家重大科研项目，对最新的产业技术做有针对性的研究，使公司的测试技术水平始终和国家产业发展方向保持一致，真正做到技术水平处于行业领先地位。同时，公司将进一步完善技术人员的激励机制，不断培养和引进高素质技术人才，做好培训工作，持续保持技术研发队伍的稳定，以保证公司的测试技术研发能力能应对市场对技术更新的需求。

（三）市场波动风险

公司属于集成电路行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供测试服务，是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将势必对集成电路测试行业带来重大影响。

公司对策：

目前国内集成电路行业正处于快速发展期，公司将充分利用国家财政、税收方面的扶植政策，提升测试技术水平，扩大生产规模。公司将重点发展行业亟需的高端 12 英寸晶圆测试技术和测试生产能力，使公司的产能结构更加符合行业市场发展的主导方向。公司将积极拓展同上下游企业的战略合作，力争形成一定数量的长期业务合作伙伴，保持稳定的市场份额。公司通过参与行业协会事务，承担政府集成电路公共测试服务平台的职能，提高企业知名度，提升行业影响力，在发展国内业务的同时，也注重拓展海外市场，进一步增强公司抵御市场风险的能力。

（四）核心技术人员流失风险

集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司拥有较强的研

发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的重要因素。随着集成电路行业的发展，集成电路企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。

公司对策：

公司对于核心技术人员施行了员工持股，使公司的发展同个人利益密切联系，增强相关人员对公司的归属感。公司针对核心技术人员制定了相对倾斜的薪酬政策和职业发展规划，使得核心技术人员在为公司发展做贡献的同时也能合理地实现个人价值。公司同所有核心技术人员签订了保密合同，以保证公司在无法挽留核心技术人员时产生的技术泄露。公司仍将策划其他管理和激励措施，以进一步降低有关核心技术人员依赖的风险。

（五）知识产权风险

公司在集成电路测试技术和程序研发中，申请了大量软件著作权、技术专利等知识产权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用，因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。

公司对策：

对于知识产权被侵犯的风险，公司施行了技术文档专人保管，核心人员签订保密协议等管理措施加以防范；同时，公司通过不断的技术更新降低知识产权被侵犯对公司经营产生的不利影响；此外，公司在必要时将及时积极运用法律手段维护自身的合法权益。

对于侵犯他人知识产权的风险，公司一直坚持独立自主进行技术研发的策略，尽可能避免侵犯他人知识产权。对于竞争对手特别是外国企业利用特定法律条款，在知识产权方面设置的障碍，公司唯有付诸法律手段。

（六）关联交易风险

2010年、2011年以及2012年1-6月，公司对控股股东复旦微电子的销售收入占公司销售收入的比例分别为44.83%、43.95%、46.54%，公司主要业务存在关联方（控股股东）占比较高的经营风险。如果控股股东的生产经营情况发生不利变化，或其竞争能力下降，将有可能减少对公司的测试业务，从而对公司的销售收入带来不利影响。

公司对策：

公司控股股东或除公司以外的其他控股子公司并无专业从事集成电路测试业务，公司自成立以来亦由公司管理层独立运作，公司控股股东作为一家生产完全代工的集成电路设计公司同公司的业务往来系互生互存之关系。近年来，复旦微电子的营业额持续增长，尚无经营情况向不利方向发展之趋势。同时，公司将通过扩充市场营销人员，加大对集成电路产业链上下游企业的市场拓展力度，寻求长期战略伙伴，使主要业务客户在集成电路设计、制造和封装等细分行业的分布呈多元化趋势，以降低关联方交易占收入比例较高的风险。

（七）税收政策变化风险

公司被认定为国家级高新技术企业，按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税，发生的研发费用可按实际发生额的 150%加计抵扣当年的企业应纳税所得额。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

公司对策：

公司将利用自身是国家和地方集成电路测试公共服务平台的独特地位，经常性的承担国家和地方的科研项目，不断开发国家重点支持、行业市场需要的产品，保持技术方面的行业领先地位，争取持续获得国家对于高新技术企业的税收政策扶持。同时，公司计划通过提升技术含量和测试质量、加强市场拓展力度，增加市场份额和业务利润，以期将公司一旦无法获得或国家取消上述税收优惠政策所带来的不利影响降至最低。

（八）大股东不当控制风险

公司的法人股东复旦微电子拥有公司 64.90%的股份，若公司控股股东及相关人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

公司对策：

公司已建立了较为合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和关联董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对大股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性。公司将严格依据《公

司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，在适当时候引入独立董事，以完善法人治理结构，切实保护少数权益股东的利益。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见：

公司自股份制改造后，制定了规范的股份公司章程、三会议事规则及针对关联交易、对外投融资和对外担保等多个专项制度。每个机构都能依照章程履行职责，共计召开股东大会 3 次、董事会 8 次、监事会 5 次。证券事务代表专人负责文档保存工作，以确保公司各项决议有案可查。自股份制改造后，股东大会、董事会、监事会制度已基本建立，运行情况良好。

（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明：

公司上述机构能够依照章程和三会议事规则履行职责，按照各自职权进行决策，至本说明书签署日，未出现违法违规情况。公司股东、董事及监事通过股份制改造工作，已对各自职责有了更为明确的了解，有能力承担章程所赋予的相关职权。“三会”人员目前均能依照三会会议通知按时参会，并提交、参与讨论、表决各类议案。

（三）公司资金未被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用；公司也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况；

（四）公司三会制度实际运作中存在缺陷及改进措施：

1、有限公司阶段，公司股东会、董事会无专门的议事规则，股份制改造后，公司已重新修订章程、制定三会议事规则及《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》、《对外投融资管理制度》，使公司三会召开、表决及重大事项决策规范化管理；

2、部分会议决议届次标注不完整，后续仍有待完善；

3、有限公司阶段，与控股股东公司复旦微电子的关联交易并未经过正式的批准程序确定交易内容及交易价格。股份制改造完成后，公司相关人员都已知悉相关关联交易决策制度，并将按这类制度严格执行审批程序，确保关联交

易定价公允，不损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

二、公司重要事项决策和执行情况

公司股份制改造后，针对对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项均由章程和相应制度作出专门规定。

最近 2 年内，公司未发生对外担保、委托理财、对外投资。

最近 2 年内，公司关联交易主要是与控股股东及其控制的企业间发生。在上海上会 2012 年 8 月 22 日出具的上会师报字（2012）第 2098 号《审计报告》中有详细披露。

自公司整体变更为股份公司后，2010 年和 2011 年年度股东大会均依法对关联交易内容进行表决，应回避股东都回避表决。

三、同业竞争情况

公司不存在与控股股东及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况。

四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

1、本章中，如不特殊注明，均引自公司经审计的财务报告，投资者欲进一步了解公司报告期财务状况，请阅读本报价说明书备查文件之财务报表及审计报告。

2、本章中，如不特殊注明，货币金额单位均以人民币元计。

一、报告期间审计意见及主要财务报表

（一）公司报告期内审计意见及会计师事务所情况

1、报告期内财务会计报告的审计意见

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1 至 6 月财务会计报告已经上海上会审计，上海上会出具了上会师报字（2012）第 2098 号标准无保留意见的审计报告。

2、最近二年更换会计师事务所的情况

公司近二年均聘请了具有证券业务资格的上海上会负责公司 2010 年、2011 年至 2012 年 6 月 30 日财务报表的审计工作，没有更换主审会计师事务所。

（二）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

1、资产负债表

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	48,043,974.31	50,346,503.89	59,434,632.58
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	9,653,554.41	6,890,008.11	6,185,365.07
预付款项	377,256.14	165,209.89	430,140.41
应收利息			
应收股利			

其他应收款	586,785.50	616,726.20	629,676.20
存货	705,255.16	23,715.09	545,709.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	59,366,825.52	58,042,163.18	67,225,523.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	44,011,454.10	36,576,138.66	21,654,762.60
在建工程	7,306,094.47	15,490,000.59	5,366,284.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出	25,060,589.75	21,690,000.00	
商誉			
长期待摊费用	3,532,302.59	4,086,014.81	1,713,944.41
递延所得税资产	44,784.53	31,963.95	57,042.88
其他非流动资产			
非流动资产合计	79,955,225.44	77,874,118.01	28,792,034.74
资产总计	139,322,050.96	135,916,281.19	96,017,558.64

(续)

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	4,729,965.95	6,913,730.00	3,146,293.26

预收款项	44,921.69	70,744.60	13,762.80
应付职工薪酬	2,301,977.50	1,257,756.96	40,181.36
应交税费	-77,372.12	1,511,340.52	694,114.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	970,616.44	464,236.45	303,863.73
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	7,970,109.46	10,217,808.53	4,198,215.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	25,101,879.00	4,293,000.00	4,293,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	45,722,421.00	60,971,300.00	38,904,000.00
非流动负债合计	70,824,300.00	65,264,300.00	43,197,000.00
负债合计	78,794,409.46	75,482,108.53	47,395,215.45
所有者权益：			
股本	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
资本公积	13,093,536.01	13,093,536.01	13,093,536.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	1,634,063.67	1,634,063.67	452,880.72
一般风险准备			
未分配利润	14,800,041.82	14,706,572.98	4,075,926.46
所有者权益合计	60,527,641.50	60,434,172.66	48,622,343.19
负债和所有者权益总计	139,322,050.96	135,916,281.19	96,017,558.64

2、利润表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年
一、营业收入	25,087,582.83	53,306,881.36	44,227,326.27
减：营业成本	10,052,993.25	21,606,730.48	17,186,649.42
营业税金及附加		641,613.46	549,897.33
销售费用	536,695.36	1,127,096.28	321,127.00
管理费用	10,280,347.32	19,804,503.77	20,152,793.90
财务费用	-567,098.00	-929,167.51	-310,091.72
勘探费用			
资产减值损失	85,470.50	14,102.06	107,692.69
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	4,699,174.40	11,042,002.82	6,219,257.65
加：营业外收入	2,000,000.00	1,897,400.00	3,108,000.00
减：营业外支出		2,754.12	44,421.03
其中：非流动资产处置损失		2,403.52	30,948.30
三、利润总额	6,699,174.40	12,936,648.70	9,282,836.62
减：所得税费用	405,705.56	1,124,819.23	1,429,072.54
四、净利润	6,293,468.84	11,811,829.47	7,853,764.08

3、现金流量表

项目	2012年1-6月	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,649,913.16	59,684,474.20	47,095,662.93
收到的税费返还			125,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,249,307.06	24,419,948.87	44,920,214.38
经营活动现金流入小计	31,899,220.22	84,104,423.07	92,140,877.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,587,252.99	10,053,660.91	14,521,776.97
支付给职工以及为职工支付的现金	4,306,742.32	11,047,369.80	8,580,326.92
支付的各项税费	1,848,751.89	3,410,945.25	3,895,667.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,914,795.06	19,225,902.94	16,586,949.34
经营活动现金流出小计	18,657,542.26	43,737,878.90	43,584,720.30
经营活动产生的现金流量净额	13,241,677.96	40,366,544.17	48,556,157.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,351,423.34	49,424,632.55	16,609,636.54
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	9,351,423.34	49,424,632.55	16,609,636.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,351,423.34	-49,424,632.55	-16,609,636.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,200,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,200,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-6,200,000.00		3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,215.80	-30,040.31	-1,600.41
五、现金及现金等价物净增加额	-2,302,529.58	-9,088,128.69	34,944,920.06
加：期初现金及现金等价物余额	50,346,503.89	59,434,632.58	24,489,712.52
六、期末现金及现金等价物余额	48,043,974.31	50,346,503.89	59,434,632.58

项目	2012年1-6月股东权益变动表金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	31,000,000.00	13,093,536.01			1,634,063.67		14,706,572.98	60,434,172.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	31,000,000.00	13,093,536.01			1,634,063.67		14,706,572.98	60,434,172.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							93,468.84	93,468.84
(一)净利润							6,293,468.84	6,293,468.84
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配							-6,200,000.00	-6,200,000.00
1、提取盈余公积								

2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-6,200,000.00	-6,200,000.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	31,000,000.00	13,093,536.01			1,634,063.67		14,800,041.82	60,527,641.50

项目	2011年股东权益变动金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	31,000,000.00	13,093,536.01			452,880.72		4,075,926.46	48,622,343.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	31,000,000.00	13,093,536.01	-	-	452,880.72		4,075,926.46	48,622,343.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,181,182.95		10,630,646.52	11,811,829.47
(一)净利润							11,811,829.47	11,811,829.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					1,181,182.95		-1,181,182.95	
1、提取盈余公积								

					1,181,182.95		-1,181,182.95	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	31,000,000.00	13,093,536.01			1,634,063.67		14,706,572.98	60,434,172.66

项目	2010年股东权益变动金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	31,000,000.00	325,000.00			2,494,357.91		6,949,221.20	36,587,906.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	31,000,000.00	325,000.00			2,494,357.91		6,949,221.20	40,768,579.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		12,768,536.01			-2,041,477.19		-2,873,294.74	7,853,764.08
(一)净利润							7,853,764.08	7,853,764.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,853,764.08	7,853,764.08
(三)所有者投入和减少资本		12,768,536.01			-2,494,357.91		-10,274,178.10	
1、所有者投入资本		12,768,536.01			-2,494,357.91		-10,274,178.10	20,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					452,880.72		-452,880.72	-

1、提取盈余公积					452,880.72		-452,880.72	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	31,000,000.00	13,093,536.01			452,880.72		4,075,926.46	48,622,343.19

二、报告期内主要财务指标

财务指标		2012年1-6月	2011年	2010年
毛利率		59.93%	59.47%	61.14%
净资产收益率	全面摊薄	10.40%	19.54%	16.15%
	加权平均	10.41%	21.66%	19.38%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	7.59%	16.88%	10.81%
	加权平均	7.59%	18.71%	12.96%
每股收益（元/股）	基本	0.20	0.38	0.25
	稀释	0.20	0.38	0.25
扣除非经常损益的每股收益（元/股）	基本	0.15	0.33	0.17
	稀释	0.15	0.33	0.17
每股净资产		1.95	1.95	1.57
资产负债率		56.56%	55.54%	49.36%
流动比率		7.45	5.68	16.01
速动比率		7.36	5.68	15.88
应收账款周转率（次）		2.60	7.74	7.15
存货周转率（次）		14.25	911.10	31.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.43	1.30	1.57

注一：上述财务指标计算公式如下：

- 1、资产负债率=负债期末余额 / 资产期末余额
- 2、流动比率=流动资产期末余额 / 流动负债期末余额
- 3、速动比率=（流动资产期末余额 - 存货期末余额） / 流动负债期末余额
- 4、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期末余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货期末余额
- 6、每股净资产=净资产期末余额 / 股本（实收资本）期末余额
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 股本（实收资本）期末余额

8、净资产收益率及每股收益按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算

主要财务指标分析见本章之“十一、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析”。

三、报告期内利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1、公司最近两年一期的主营业务收入占营业收入比

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
主营业务收入	25,087,582.83	53,306,881.36	44,227,326.27
营业收入	25,087,582.83	53,306,881.36	44,227,326.27
主营业务收入/营业收入	100%	100%	100%

报告期内，公司专注于主业，没有开展其他业务，主营业务突出。

2、公司最近两年的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

行业名称	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路测试及开发服务	25,087,582.83	10,052,993.25	53,306,881.36	21,606,730.48	44,227,326.27	17,186,649.42

公司专注于集成电路测试及开发服务，报告期内主营业务收入上升增长趋势明显，高于集成电路行业及半导体行业的总体发展速度。公司近年来加大了对研发技术的投入以及先进高精度测试设备的引进，随着公司在行业内地位的提高以及市场开发能力的加强，公司销售将保持稳定增长。

(二) 主营业务收入和净利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2012年1至6月	2011年度	2010年度	2011年较2010年变动
营业收入	25,087,582.83	53,306,881.36	44,227,326.27	20.53%
营业成本	10,052,993.25	21,606,730.48	17,186,649.42	25.72%
毛利	15,034,589.58	31,700,150.88	27,040,676.85	17.23%
营业利润	4,699,174.40	11,042,002.82	6,219,257.65	77.55%
利润总额	6,699,174.40	12,936,648.70	9,282,836.62	39.36%
净利润	6,293,468.84	11,811,829.47	7,853,764.08	50.40%

2011年销售收入较2010年增长20.53%，毛利水平保持稳定，营业利润增长4,822,745.17元，同时销售费用与管理费用合计额仅增长457,679.15元，受两方面的影响，公司净利出现较快的增长，2011年盈利同比增长50.40%，增长速度高于销售收入。随着公司市场开发能力的不断加强，销售将逐年呈增长态势，规模优势将愈加凸显，盈利能力将随着销售的增长而增强。

(三) 主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及其变动情况如下表：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年
销售费用	536,695.36	1,127,096.28	321,127.00
管理费用	10,280,347.32	19,804,503.77	20,152,793.90
财务费用	-567,098.00	-929,167.51	-310,091.72
期间费用小计	10,249,944.68	20,002,432.54	20,163,829.18
营业收入	25,087,582.83	53,306,881.36	44,227,326.27
销售费用/营业收入	2.14%	2.11%	0.73%
管理费用/营业收入	40.98%	37.15%	45.57%
期间费用/营业收入	40.86%	37.52%	45.59%

报告期内，营业收入费用率维持在比较稳定的水平，没有出现较大变动，其中管理费用占比较高。管理费用中的技术开发费占费用的比重最大，报告期内占费用总额的 54.90%，主要原因是公司为技术密集型行业，为了提高专业测试能力，维持行业地位而需要不断地加大技术研发投入，从而使该项支出较大。

由于公司资金情况良好，公司利息收入较多，财务费用在报告期间均为负数。

总体而言，报告期间公司成本费用与收入配比合理。

(四) 重大投资和非经常性损益情况**1、重大投资**

公司在报告期内无重大对外投资。

2、非经常性损益

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-2,403.52	-30,948.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00	1,840,400.00	3,108,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	56,649.40	-13,472.73

非经常性损益合计	2,000,000.00	1,894,645.88	3,063,578.97
减：非经常性损益的所得税影响	300,000.00	284,249.47	461,557.76
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	1,700,000.00	1,610,396.41	2,602,021.22

公司属于国家政策扶持的集成电路测试企业，非经常性损益主要是公司获得的各项政策扶持补助及研发项目补助。

3、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 公司适用的主要税种、税率及计税基础列示如下：

税种	税率	计税基数
企业所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%、6%	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	应税营业额
城建税	1%	应纳增值税额和营业税额

(2) 企业所得税

经上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局编号为浦税十五所减(2009)高086号、所签报为浦税十五所高核(2009)第086号《高新技术企业所得税减免通知书》核定：自2009年1月1日至2010年12月31日止，减按15%税率征企业所得税；经上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局编号为浦税十五所备(2012)高082号、所签报号为浦税十五所减(2012)第082号《高新技术企业所得税减免通知书》核定：自2011年1月1日至2013年12月31日止，减按15%税率征企业所得税。

(3) 增值税

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家税务总局财税[2011]110号《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》以及中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家税务总局财税[2011]111号《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，本公司自2012年1月1日起纳入营业税改征增值税试点范围，原属于缴纳营业税范围的业务变更为缴纳增值税，适用税率为6%。

四、报告期内的主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		200-12-31	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
现金						
人民币		17,172.23		2,076.10		1,611.57
小计		17,172.23		2,076.10		1,611.57
银行存款						
人民币		46,418,272.67		49,736,238.40		59,244,082.80
美元	254,316.97	1,608,529.41	96,524.21	608,189.39	28,528.88	188,938.21
小计		48,026,802.08		50,344,427.79		59,433,021.01
合计		48,043,974.31		50,346,503.89		59,434,632.58

报告期内货币资金账面余额较大，公司经营性现金流较好。

期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

(二) 应收账款

1、报告期内应收账款按种类分类的期末余额及坏账计提情况：

单位：元

账龄	2012年6月30日			
	余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	9,952,117.95	100.00%	298,563.54	9,653,554.41
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	9,952,117.95	100.00%	298,563.54	9,653,554.41
账龄	2011年12月31日			
	余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	7,103,101.15	100.00%	213,093.03	6,890,008.12
1-2年				
2-3年				
3-4年				
合计	7,103,101.15	1.00	213,093.03	6,890,008.12
账龄	2010年12月31日			
	余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	6,242,066.06	97.77%	187,261.98	6,054,804.07

1-2年	50,000.00	0.78%	2,500.00	47,500.00
2-3年	92,289.99	1.45%	9,229.00	83,060.99
合计	6,384,356.05	100.00%	198,990.98	6,185,365.07

2、主要客户明细

截至2012年6月30日，应收账款前五名合计8,226,989.52元，占总额比例82.67%，具体列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	形成原因
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	3,437,047.92	1年之内	营业收入
2	深圳国威电子有限公司	1,819,941.60	1年之内	营业收入
3	无锡中微腾芯电子有限公司	1,590,000.00	1年之内	营业收入
4	上海集成电路技术与产业促进中心	700,000.00	1年之内	营业收入
5	上海交通大学	680,000.00	1年之内	营业收入

3、应收账款说明

近几年来公司应收账款占流动资产及资产总额的比例保持在比较稳定的水平。应收账款构成中最大的债权系公司应收复旦微电子的债权，其在2012年6月末余额较多，主要原因为2012年6月公司向其实实现的含税销售3,375,307.92元，由于公司与复旦微电子的货款结算在一个月左右，从而造成公司应收该单位的债权大幅增加，至7月份公司已基本收到前述货款。

报告期间公司货款回笼情况较好，应收债权资产质量较好，而且从账龄来看，公司应收账款账龄均在一年以内，回收情况良好，并按规定会计政策和估计提取了坏账准备。

另外，除应收控股股东复旦微电子正常销售款项外，不存在公司应收持公司5%以上表决权股份的其他股东款项及以应收债权融资或出售应收债权的情形。

（三）其他应收款

1、报告期内其他应收款期末余额、净值、账龄情况

单位：元

账龄	2012-6-30		2011-12-31		2010-12-31	
	金额	净额	金额	净额	金额	净额
1年以内	586,785.50	586,785.50	616,726.20	0.00	629,676.20	629,676.20
1年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	586,785.50	586,785.50	616,726.20	0.00	629,676.20	629,676.20
----	------------	------------	------------	------	------------	------------

2、主要债务人情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限
上海张江文化控股有限公司	房租押金	556,373.50	1年以内
备用金	员工备用金	30,412.00	1年以内
合计		586,785.50	

3、其他应收款说明

公司其他应收款科目主要归集公司员工出差或办理公司事务的押金或保证金等。报告期内公司未发生过坏账事项，目前最大其他应收债权是公司支付给上海张江文化控股有限公司的房屋租赁保证金，公司生产经营场所系租赁该公司的。

总体来看，公司其他应收款债务人及金额均较少，占用公司资金也较少，账龄均在一年以内，业务往来正常，没有发生过坏账。公司对其他应收款采取个别认定法进行减值测试，报告期间无减值迹象。

另外，公司无应收持公司 5%以上表决权股份的股东款项，亦不存在以其他应收债权融资或出售其他应收债权的情形。

（四）存货

公司报告期的存货情况如下：

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
原材料	13,197.69	6,792.30	239,315.91
生产成本-测试支出	692,057.47	16,922.79	306,393.73
合计	705,255.16	23,715.09	545,709.64

存货取得时按照实际发生成本入账，原材料领用和发出时按加权平均法计价。产成品和发出商品领用和发出时按先进先出法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

公司的主要主营业务是为集成电路产品提供测试服务，作为以提供集成电路测试服务为主的公司，材料的消耗量较少，存货占用资金不大，其生产成本构成主要为机器设备的折旧、人员工资等，公司在会计期末存货余额占总资产的比重

很小，2010年、2011年以及2012年6月30日存货与总资产的比分别为0.6%、0.02%和0.5%。另外，公司2011年末存货余额仅23,715.09元，主要由于当年末公司承接的测试业务基本完成，在测试中的业务很少。

截至2012年6月30日，公司的存货不存在减值因素，无需计提跌价准备。

（五）固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
办公设备	5年	4.00%	19.20%
运输设备	5年	4.00%	19.20%
机器设备	5年	4.00%	19.20%

公司固定资产折旧均采用直线法。

2、固定资产原值、累计折旧和净值

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
原值			
机器机械设备	80,868,463.97	67,195,368.66	45,842,477.77
办公管理用具	778,292.97	771,943.97	680,268.39
交通运输工具	1,735,829.33	1,735,829.33	1,232,360.25
合计	83,382,586.27	69,703,141.96	47,755,106.41
累计折旧			
机器机械设备	37,919,001.96	31,882,089.53	25,182,462.33
办公管理用具	416,398.08	356,784.40	211,270.15
交通运输工具	1,035,732.13	888,129.37	706,611.33
合计	39,371,132.17	33,127,003.30	26,100,343.81
净值			
机器机械设备	42,949,462.01	35,313,279.13	20,660,015.44
办公管理用具	361,894.89	415,159.57	468,998.24
交通运输工具	700,097.20	847,699.96	525,748.92
合计	44,011,454.10	36,576,138.66	21,654,762.60
减值准备			
机器机械设备			
办公管理用具			

交通运输工具			
净额	44,011,454.10	36,576,138.66	21,654,762.60

公司的机器设备主要为高精技术设备，设备的技术性能良好，会计核算中基于稳健性原则固定资产的预计使用年限估计趋于谨慎，公司生产设备的实际可使用时间均比会计的折旧年限要长，因此公司累计折旧占固定资产原值较大，并不意味着公司机器设备存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，公司目前固定资产配置满足公司生产的持续经营需要。

公司固定资产不存在抵押、担保等受限情况。

（六）在建工程

1、在建工程明细情况

单位：元

项目	2012年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值
专用设备	7,306,094.47		7,306,094.47
净化车间扩建			-
合计	7,306,094.47		7,306,094.47

项目	2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
专用设备	14,979,810.59		14,979,810.59
净化车间扩建	510,190.00		510,190.00
合计	15,490,000.59		15,490,000.59

项目	2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
专用设备	2,523,064.85		2,523,064.85
净化车间扩建	2,843,220.00		2,843,220.00
合计	5,366,284.85		5,366,284.85

2、在建工程情况说明

截止2012年6月30日，公司在建工程中的专用设备均为测试服务使用的探针台、测试机及其配套设备，因没有安装调试完毕未转入固定资产。

（七）开发支出

1、开发支出明细表

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年6月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
核心电子器件评价与检测技术	3,530,000.00				3,530,000.00
极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用技术	18,160,000.00				18,160,000.00
多目标先进封装和测试公共服务平台技术		3,370,589.75			3,370,589.75
合计	21,690,000.00	3,370,589.75			25,060,589.75

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
核心电子器件评价与检测技术		3,530,000.00			3,530,000.00
极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用技术		18,160,000.00			18,160,000.00
合计		21,690,000.00			21,690,000.00

2、开发支出情况说明

公司承担上述三个国家重大科研项目，按照课题负责方的要求，严格按照《国家科技重大专项管理暂行条例》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》及《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》等执行，非设备类研发投入分项目核算，以上项目均已达到开发阶段，符合资本化支出条件，待课题负责方验收合格且达到无形资产确认条件后按国家会计规定结转。

（八）对外投资情况

公司在报告期间虽然资金流较好，但公司坚持做好主业，没有发生对外投资事项。

（九）长期待摊费用

单位：元

项目	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31
净化车间装修、消防工程等	3,532,302.59	4,086,014.81	1,713,944.41

长期待摊费用为公司对租赁生产经营场所的装修改造费用，公司对其按5年

期限平均摊销。

(十) 资产减值准备会计政策及计提情况

1、应收账款、其他应收款坏账准备会计政策

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额重大的应收账款为前五名款项；

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：账龄超过 3 年或尚未超过 3 年但根据可收回性应全额计提坏账准备的应收账款；

根据信用风险特征组合确定的计提方法：各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 对于上述经单独测试后未减值的以及其他部分应收账款按账龄分析法计提坏账准备：

账龄	计提比例
1 年以内(含 1 年)	3.00%
1—2 年(含 2 年)	5.00%
2—3 年(含 3 年)	10.00%
3—4 年(含 4 年)	50.00%
4—5 年(含 5 年)	80.00%
5 年以上	100.00%

2、其他的应收款项坏账准备会计政策

对于其他应收款、应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3、其他资产类减值准备政策

(1) 存货

在资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。在资产负债表日，如果存

货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(4) 固定资产

如存在固定资产可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、公司资产减值准备实际执行情况

截至 2012 年 6 月 30 日，公司除对应收账款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。报告期内相关会计科目资产减值准备计提情况如下：

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年
资产减值准备	85,470.50	14,102.06	107,692.69
其中：应收账款坏账准备	85,470.50	14,102.06	107,692.69

五、报告期内的重大债务情况

(一) 应付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012-6-30		2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	4,729,965.95	100.00%	6,913,730.00	100.00%	3,146,293.26	100.00%
1年至2年						
2年至3年						
3年以上						
合计	4,729,965.95	100.00%	6,913,730.00	100.00%	3,146,293.26	100.00%

2、前五名债务人情况

单位：元

客户名称	2012-6-30	账龄	形成原因
深圳市国微电子股份有限公司	2,205,000.00	1年以内	未付货款
上海至益电子技术有限公司	976,375.00	1年以内	未付货款
上海泉腾贸易有限公司	358,000.00	1年以内	未付货款
苏州市华晨洁净空调技术有限公司	99,580.00	1年以内	装修工程质保金
上海华之旅旅行社有限公司	87,000.00	1年以内	未付货会务费

截至2012年6月30日，应付前五名合计3,725,955.00元，占总额比例78.77%。

3、应付账款情况说明

公司应付账款主要反映向供应商采购的集成电路测试服务、研发用原材料等业务形成的往来。在长期发展过程中，公司与供应商形成良好的合作关系，公司资金状况良好，货款能够按合同及时支付。

截至2012年6月30日，无欠持公司5%以上(含5%)股份股东单位的款项。

(二) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,200,000.00	4,934,376.74	3,904,376.74	2,230,000.00
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	50,037.80	1,234,422.84	1,222,025.30	62,435.34
其中：① 医疗保险费	8,706.20	353,742.50	351,605.30	10,843.40
② 养老保险费	37,340.40	781,368.14	772,009.50	46,699.04
③ 生育保险费		19,586.80	19,586.80	
④ 失业保险费	3,991.20	66,939.70	66,038.00	4,892.90
⑤ 工伤保险费		12,785.70	12,785.70	
(4) 住房公积金	7,719.16	332,901.00	331,078.00	9,542.16
(5) 工会经费				
(6) 职工教育经费				
(7) 其他		48,000.00	48,000.00	

合计	1,257,756.96	6,501,700.58	5,505,480.04	2,301,977.50
----	--------------	--------------	--------------	--------------

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
(1)工资、奖金、津贴和补贴		9,640,561.30	8,440,561.30	1,200,000.00
(2)职工福利费		530,616.19	530,616.19	
(3)社会保险费	32,855.20	2,103,952.32	2,086,769.72	50,037.80
其中：①医疗保险费	5,984.20	608,910.82	606,188.82	8,706.20
②养老保险费	23,936.30	1,322,615.62	1,309,211.52	37,340.40
③生育保险费		27,075.93	27,075.93	
④失业保险费	2,934.70	123,519.72	122,463.22	3,991.20
⑤工伤保险费		21,830.23	21,830.23	
(4)住房公积金	7,326.16	600,171.00	599,778.00	7,719.16
(5)工会经费		6,000.00	6,000.00	
(6)职工教育经费		6,910.00	6,910.00	
(7)其他		40,000.00	40,000.00	
合计	40,181.36	12,928,210.81	11,710,635.21	1,257,756.96

项目	2009年12月31日	本期增加额	本期减少额	2010年12月31日
(1)工资、奖金、津贴和补贴	286,522.97	5,675,141.29	5,961,664.26	
(2)职工福利费		535,141.84	535,141.84	
(3)社会保险费	28,234.16	1,704,362.50	1,699,741.46	32,855.20
其中：①医疗保险费	5,133.48	462,347.59	461,496.87	5,984.20
②养老保险费	20,533.94	1,099,575.17	1,096,172.81	23,936.30
③生育保险费		17,192.15	17,192.15	
④失业保险费	2,566.74	108,055.44	107,687.48	2,934.70
⑤工伤保险费		17,192.15	17,192.15	
(4)住房公积金		241,799.00	234,472.84	7,326.16
(5)工会经费	7,447.80	28,709.70	36,157.50	
(6)职工教育经费		330,420.00	330,420.00	
(7)其他				
合计	322,204.93	8,515,574.33	8,797,597.90	40,181.36

(三) 应交税费

税种	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
营业税		350,509.95	232,964.70

代扣代缴个人所得税	191,870.64	18,100.26	24,121.53
城市维护建设税	1.35	3,506.45	2,329.65
企业所得税	443,350.08	1,498,530.18	802,127.21
增值税	-712,602.27	-380,345.00	-376,747.38
教育费附加	6.73	17,532.23	6,988.94
河道工程修建维护管理费	1.35	3,506.45	2,329.65
合计	-77,372.12	1,511,340.52	694,114.30

(四) 其他应付款

1、余额情况

单位：元

账龄	2012-6-30		2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	970,616.44	100.00%	464,236.45	100.00%	303,863.73	100.00%
1年至2年(含2年)						
2年至3年(含3年)						
3年以上						
合计	970,616.44	100.00%	464,236.45	100.00%	303,863.73	100.00%

2、其他应付款情况说明

截至2012年6月30日，其应付款中无应付公司5%以上(含5%)表决权股份的股东或关联方单位的款项。

期末余额中无账龄超过1年的大额其他应付款的情况。

(五) 专项应付款

单位：元

研发项目	专项应付款余额		
	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
微控制器系列产品的测试技术开发	75,000.00	75,000.00	75,000.00
SOC测试技术研究	309,000.00	309,000.00	309,000.00
高性能数字音视频SOC芯片测试技术研究	309,000.00	309,000.00	309,000.00
12英寸极大规模集成电路测试线建设	7,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用	17,208,879.00	-	-

合计	25,101,879.00	4,293,000.00	4,293,000.00
----	---------------	--------------	--------------

本科目系根据《中央与预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》及《上海市科研计划课题管理办法》等规定，将政府补助资金购置的固定资产归属于国有资产部分转入。

报告期内，公司专项应付款尚未转入资本公积。

（六）其他非流动负债

单位：元

项目	2012年6月	2011年	2010年
集成电路测试技术公共服务平台建设	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
宇航用核心电子器件评价与检测技术	3,000,000.00	3,000,000.00	350,000.00
极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用（国拨及地拨）	18,551,121.00	35,760,000.00	24,154,000.00
极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用（浦东新区配套项目）	1,063,300.00	1,063,300.00	-
高性能模数转换器测试技术研究	1,800,000.00	1,620,000.00	1,260,000.00
上海华岭虚拟测试平台建设	270,000.00	270,000.00	240,000.00
科技小巨人培育企业项目	1,278,000.00	1,278,000.00	-
集成电路测试公共服务平台建设	7,560,000.00	3,780,000.00	-
芯片级电路快速并行测试技术研究	1,200,000.00	1,200,000.00	-
数字音视频芯片高速测试技术研究	-	1,000,000.00	1,000,000.00
4Gbps 宽带无线通信 RFSOC 芯片测试环境建设		1,000,000.00	900,000.00
合计	45,722,421.00	60,971,300.00	38,904,000.00

公司非流动负债均为政府补助形成的递延收益。公司对收到的各项补贴按会计准则要求进行分类核算，其中与资产相关的政府补助以及与收益相关的用于补偿以后期间的相关费用或损失的政府补助，在递延收益中核算。

六、报告期内各期末股东权益情况

1、股东权益明细

单位：元

项目	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31
实收资本(或股本)	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
资本公积	13,093,536.01	13,093,536.01	13,093,536.01
盈余公积	1,634,063.67	1,634,063.67	452,880.72
未分配利润	14,800,041.82	14,706,572.98	4,075,926.46
所有者权益合计	60,527,641.50	60,434,172.66	48,622,343.19

2、股东权益情况说明

(1) 股本（实收资本）的变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的详见本说明书第五章“公司基本情况”：“二、历史沿革”。

(2) 资本公积的形成：公司从有限公司变更为股份有限公司时，对以 2010 年 4 月 30 日为基准日经审计确认的净资产按 1:0.7030509 的比例折合股本 3100 万股后剩余净资产全部计入公司资本公积金。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）控制关系的关联方情况

公司的主要控股股东为复旦微电子，复旦微电子持有公司 64.90% 股份，该公司的相关情况如下：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
复旦微电子	母公司	股份公司	上海市	蒋国兴	研发微电子产品及销售、自产产品并提供相关服务	6,173.30 万

（二）不存在控制关系的关联方情况

除上述控制股东外，公司还与另一关联方——复控华龙存在交易，该公司的控股股东为复旦微电子，即与公司受同一方控制。

公司与母公司及复控华龙均属于集成电路行业，其中母公司主要从事微电子产品的研究开发与生产，复控华龙主要从事微电子产品、电子元器件的研发、制造、销售及微系统技术的研发，这两家公司与公司属于同一产业链中的上下游关系，公司利用集成电路测试技术的优势为前述两家公司提供专业化的测试服务。

公司与上海复旦微电子（香港）有限公司（复旦微电子持有该公司 100% 的股权）、深圳市复旦微电子有限公司（复旦微电子持有该公司 100% 的股权）、北京复旦微电子技术有限公司（复旦微电子持有该公司 100% 的股权）等关联方不存在交易。

（三）关联交易情况

公司在公司章程中对关联交易的审批权限作了规定，制订并通过了《关联交易决策制度》。公司的关联交易价格公允，不存在利益输送。

公司关联交易类型主要包括销售商品及提供劳务、共同承担政府项目、采购商品、关键管理人员支付的薪酬等，具体如下：

1、销售商品及提供劳务

公司与关联方交易相关情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式
复旦微电子	提供劳务	集成电路测试及开发服务	按市场定价与协议定价相结合
复控华龙	提供劳务	集成电路测试及开发服务	按市场定价与协议定价相结合

报告期间，公司与上述关联方交易情况如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
公司营业收入	25,087,582.83	53,306,881.36	44,227,326.27
其中：公司对复旦微电子实现收入	11,676,345.72	23,429,692.62	19,827,155.17
公司对复控华龙实现收入	19,891.51	1,605,653.85	2,453,854.70
公司对复旦微电子实现收入/公司营业收入	46.54%	43.95%	44.83%
公司对复控华龙实现收入/公司营业收入	0.08%	3.01%	5.55%
公司对复旦微电子、复控华龙实现收入/公司营业收入	46.62%	47%	50.38%

公司收入中关联方的占比较高，主要原因是公司作为复旦微电子的子公司，在产能安排上首先要满足股东单位的测试需求，同时经过多年的磨合已经形成相对稳定的合作关系，复旦微电子愿意将其测试需求放到公司。随着公司规模的不间断扩大、测试能力的不断提高，公司的客户正逐年增加，随着公司的进一步发展，关联交易占公司收入的比重将会下降。

2、共同承担政府项目

公司与复旦微电子合作承担部分政府项目，并通过复旦微电子进行资金划拨，其中在营业外收入反映的具体情况如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
公司营业外收入		1,897,400.00	3,108,000.00
其中：公司对复旦微电子实现营业外收入		560,000.00	1,280,000.00
公司对复控华龙实现营业外收入			
公司对复旦微电子实现营业外收入/公司营业外收入		29.51%	41.18%
公司对复控华龙实现营业外收入/公司营业外收入			
公司对复旦微电子、复控华龙实现营		29.51%	41.18%

业外收入/公司营业外收入			
--------------	--	--	--

3、采购商品

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式
复旦微电子	采购商品	集成电路芯片采购	按市场定价与协议定价相结合
复控华龙	采购商品	集成电路芯片采购	按市场定价与协议定价相结合

报告期间，公司与上述关联方交易额如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
公司对复旦微电子采购金额	960,000.00	3,730,885.47	1,367,521.37
公司对复控华龙采购金额		1,474,359.00	2,261,581.23
公司对复旦微电子采购金额/公司采购金额	13.40%	26.46%	19.34%
公司对复控华龙采购金额/公司采购金额		10.46%	31.99%
公司对复旦微电子、复控华龙采购金额/公司采购金额	13.40%	36.92%	51.33%

4、关联方应收(付)款项

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
应收账款总额	9,952,117.95	7,103,101.15	6,384,356.05
其中：复旦微电子	3,437,047.92	1,608,162.31	1,580,631.96
复控华龙			
公司对复旦微电子应收账款/应收账款总额	34.54%	22.64%	24.76%
公司对复控华龙应收账款/应收账款总额			
公司对复旦微电子、复控华龙应收账款/应收账款总额	34.54%	22.64%	24.76%

5、报告期内为关键管理人员支付的薪酬

单位：元

姓名	2012年1月至6月	2011年1月至12月	2010年1月至12月
施瑾(董事长)	218,960.00	401,760.00	325,500.00
张志勇(总经理)	218,960.00	401,760.00	325,500.00
叶守银(副总经理)	197,856.00	366,336.00	296,800.00
刘远华(副总经理)	202,940.00	369,000.00	297,250.00
余军(董事)	0.00	0.00	0.00

王 苏(董事)	0.00	0.00	0.00
卢尔健(董事)	36,000.00	36,000.00	36,000.00

6、关联交易定价政策

公司与关联方的经常性交易，如销售、采购等，系正常商业往来，采用市场价格(指与独立第三方交易的价格)，如无市场价格，则采用协议价格。

公司与关联方的偶发性交易，如共同承接政府项目等，采用协议价格。

八、需提醒投资者关注财务报表附注的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后重大事项

报告期内公司无需要说明的资产负债表日后重大事项。

(二) 或有事项及其他重要事项

报告期内公司无需要披露的对外担保及重大诉讼等或有事项，亦无需要披露的其他重大或有事项及其他事项。

九、股利分配政策和报告期内的分配情况

(一) 股利分配的一般政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

(二) 报告期内的分配情况

报告期内，公司按规定计提了法定公积金。另公司于 2012 年 3 月 22 日召开 2011 年度股东大会，会议决议以 2011 年末总股本 3100 万股为基数，向全体股东派发现金红利 620 万元（含税），公司已于 2012 年 6 月支付完毕。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无子公司，因此不需要合并报表。

十一、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）盈利能力分析

公司近几年来市场销售逐年增长，2012年1-6月实现收入25,087,582.83元，同比增长43.24%；2011年收入53,306,881.36元，较2010年增长20.53%。同时公司盈利亦连续保持增长，2012年1-6月实现净利6,293,468.84元，同比增长179.13%；2011年盈利11,811,829.47元，同比增长50.40%，增长速度均高于销售收入。

同时，以营业利润来源为基础对公司盈利能力进行分析，2011年较2010年毛利增长4,659,474.03元，期间费用额增长幅度远低于收入，其中销售费用与管理费用合计增长457,679.15元，增长速度为2.24%，体现出公司该两项费用的固定费用性质特征。受毛利增长，而费用变化不大的影响，2011年营业利润同比增长4,822,745.17元，增幅77.55%，远高于收入，真实反映了企业的实际经营状况。

结合财务指标对比分析，近几年来公司毛利率较为稳定，随着公司业务的发展，净资产收益率、每股收益等盈利能力指标2011年均较同期有所提高。

综上，公司盈利能力较强，近几年来盈利均呈逐年增长趋势。

（二）偿债能力分析

截止2012年6月30日，公司资产负债率为56.56%，较2011年12月31日的55.54%及2010年12月31日的49.36%略有提高，主要受其他非流动负债等影响，并非银行借款及商业信用类负债出现大幅增长。公司属于第一批国家鼓励的集成电路企业，在集成电路测试领域处于领先地位，属于国家政策扶持企业；近几年随着公司专业技术及装备水平的提高，特别是国家对集成电路发展的重视，公司获取的各项政府补助较多，其他非流动负债及专项应付款增加较多，使公司负债率呈现出前述变化。从资金来源来看，公司近几年来没有对外举债，债务主要由商业信用、递延收益及专项应付款等构成，其中商业信用占比较低，实质上需要公司偿还的债务较少。而且从资金构成来看，2012年6月30日货币资金余额48,043,974.31元，占公司总资产的34.48%。因此，公司长期偿债能力较强，财务风险较小。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司流动比率及速动比率分别为 7.43、7.34，高于 2011 年 12 月 31 日的 5.68、5.68，但低于 2010 年 12 月 31 日的 16.01、15.88，主要原因是随着公司经营的扩大，对外设备及服务等需求增加，从而使 2011 年及以后应付账款等增长较多，引起流动比率及速动比率下降。该变化符合公司的经营状况，并非短期偿债能力的异常变动，亦非公司短期偿债能力出现下降。

综上，公司无论长期偿债能力还是短期偿债能力均较强，财务风险较小。

（三）营运能力分析

公司存货周转率较高，与公司业务特征相符。公司主要提供集成电路的测试服务，与普通加工企业存在较大的差异，测试服务耗时较短，存货周转速度较快。其中 2011 年公司存货周转率偏高的现象，系由该年末存货余额偏低造成的。剔除 2011 年该指标偏高因素后，其他期间公司的存货周转率合理。

2012 年 6 月 30 日公司应收账款周转率为 2.60 次，低于其他期间数据，除了半年时间因素及公司销售分布原因外，还受 6 月份当月与复旦微电子的大额交易影响，剔除前述因素的影响后，应收账款周转率近几年来变化幅度不大。公司应收账款余额与营业收入的变动趋势同向，应收账款水平合理。从应收账款明细资料来分析，公司应收债权比较集中，均为公司主要客户，目前均与公司保持着良好的业务关系，与这些客户有往来在近几年没有发生过坏账，货款回收正常。

综上，公司存货周转率及应收账款周转率合理，营运能力较强。

（四）获取现金能力分析

近几年公司经营性现金流量状况均较好，资金比较充沛，但每股经营活动产生的现金流量净额逐年下降，2012 年上半年、2011 年及 2010 年分别为 0.43 元/股、1.30 元/股、1.57 元/股，主要原因系政府补助类拨款在各年度分布不均匀造成的，剔除此因素后，公司正常营业收入产生的现金流与公司的收入均呈同向变化，反映了公司经营性现金流变动并非公司主营业务收入出现下降，符合公司的实际经营情况。

同时结合应收账款余额分析，公司的营业收入回款较快，在报告期内形成的业务收入没有发生过坏账，应收债权质量较好。

综上，公司获取现金能力较强。

第十一章 备查文件

一、公司章程

二、上海上会对上海华岭集成电路技术股份有限公司 2010 年、2011 年及 2012 年 1 至 6 月财务报告出具的审计报告

三、上海汉商律师事务所对上海华岭集成电路技术股份有限公司出具的法律意见书

四、上海市金融服务办公室出具的上海华岭集成电路技术股份有限公司股份报价转让试点资格确认函

五、上海证券有限责任公司关于推荐上海华岭集成电路技术股份有限公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让的推荐报告

（正文完）

(本页无正文,为上海华岭集成电路技术股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页)

(董事签字)

张立勇
卢尔健
陈军



(签章)

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2012年9月4日